股票简称：威尔高　　股票代码：301251

江西威尔高电子股份有限公司

Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd.

注册地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号

威尔高
WELGAO

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

国联民生证券承销保荐有限公司
GUOLIAN MINSHENG INVESTMENT BANKING COMPANY LIMITED

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二六年十一月

声 明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

一、本次向特定对象发行 A 股股票情况

（一）本次向特定对象发行股票相关事宜已经公司第二届董事会第十四次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施，最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。

（二）本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及其授权人士根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规、部门规章和规范性文件对向特定对象发行的发行对象有新的规定，公司届时将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均以现金方式认购。

（三）本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

本次发行通过竞价方式确定发行价格。若国家法律法规、部门规章和规范性文件对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。最终发行价格由董事会

及其授权人士根据股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

（四）本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，同时本次发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%。最终发行数量上限以中国证监会同意本次发行注册的批复为准。

若公司在审议本次发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本除权事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行数量由公司董事会根据股东会的授权在发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）本次发行完成后，发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、部门规章和规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期满后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

（六）本次发行募集资金总额不超过 130,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目	74,830.88	60,000.00
2	泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目	71,749.91	60,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	10,000.00	10,000.00
合计		**156,580.79**	**130,000.00**

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定予以置换。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述拟投入募

集资金总额，在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会及其授权人士可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的投入优先顺序和各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整各项目拟投入金额。

（七）本次向特定对象发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东按发行后的股份比例共享。

（八）本次发行股东会决议的有效期为自公司股东会审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案之日起 12 个月内。

二、提请投资者重点关注的风险

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）募投项目收益不及预期的风险

公司本次募集资金用于“江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目”、“泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目”以及“补充流动资金及偿还银行贷款”。未来整体市场环境、供求关系尚存在不确定性，若在募投项目实施过程中宏观经济、产业政策、市场需求等发生重大不利变化，可能出现行业竞争加剧的情形，或者产品技术路线发生重大更替、公司市场开拓不力、无法满足下游客户需求或其他不可抗力因素出现，**可能导致募投项目产品价格下行或销量不及预期**，进而可能导致募集资金投资项目实际效益不及预期**的风险**。

（二）新增产能消化风险

2025 年度，公司印制电路板产能规模为 245.71 万平方米/年，本次募集资金投向围绕公司 PCB 主业进行布局，旨在增加公司高端产品产能，项目建成达产后，将形成年产 264 万平方米高端 AI 类及高多层电路板产能；**此外，前次募投项目建成后将新增产能 120 万平方米/年，累计新增产能 384 万平方米/年，较 2025 年度产能扩产 1.56 倍**。当前较多同行业公司普遍在进行规模扩张，积

极增加产能，现阶段行业呈现集中扩产态势，**产能集中释放的累积效应预计在 2-3 年集中显现，与发行人本次募投项目的投产时间窗口存在一定重叠，**未来可能因新增产能陆续释放引发需求不足的风险，可能对募投项目产能消化形成压力。**本次募投项目重点聚焦 AI 服务器电源等领域，**如果项目建成投产后，**AI 服务器电源市场增长不及预期，**PCB 行业出现下游需求增长放缓甚至下滑、行业内同质化竞争加剧、新增产能投产速度过快、重大技术革新并形成替代、下游市场需求发生重大变化、公司客户开拓力度不及预期或其他重大不利变化的情形，可能导致市场需求增长不及预期以及产品推广困难，进而可能导致公司募投项目新增产能无法及时消化，**本次募投项目新增产能面临一定的产能消化风险**。

（三）固定资产折旧增加对公司经营业绩产生不利影响的风险

公司本次募集资金拟主要投向“江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目”和“泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目”，同时，公司前次募投项目“年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路板项目”正处于建设期，公司计划投入较大金额用于设备采购和工程建设等资本性支出。公司前次及本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产较本次发行前将有所增加，由此带来每年固定资产折旧、无形资产摊销的增长，预计达产年度新增折旧及摊销金额为 14,964.10 万元。**投产初期折旧计提与收入贡献之间存在明显的时间错配，导致投产初期项目利润为负，**募集资金投资项目的建设需要一定的周期，**折旧及摊销为固定成本，在产能利用率不足的情形下，单位产品折旧成本被动抬升，项目盈利空间将被压缩。**若本次募投项目建设过程中公司经营环境发生重大不利变化或者募投项目建成后经济效益不及预期，**募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响**。

（四）毛利率波动的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 22.97%、18.09%、19.12%和 18.65%，受行业竞争激烈、原材料价格上涨等因素影响，公司综合毛利率整体有所波动。

如果未来行业竞争进一步加剧导致产品销售价格下降，而公司未能及时通

过提高技术水平和产品质量以应对市场竞争；或者原材料价格上升，而公司未能有效控制产品成本等情况发生，则存在毛利率下滑和盈利能力下降的风险。

（五）原材料供应紧张及价格波动风险

公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、金盐等，主要原材料价格受国际市场铜、金等大宗商品的影响较大。主要原材料供应链的稳定性和价格波动将影响公司的生产稳定性和盈利能力；若未来原材料供应紧张、价格大幅上涨，而公司不能通过提高产品价格或通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，可能出现原材料供应不足或盈利能力下降等情形，将对公司的经营成果产生不利影响。

（六）行业产能大幅扩张导致产品价格下降的风险

近年来，全球 PCB 产业重心持续向国内聚集，我国已发展成为全球印制电路板的主要生产基地。近几年国内 PCB 产能仍处于扩张态势，若未来行业出现市场竞争加剧导致产品价格下行，而公司未能持续提升技术水平、生产管理、产品质量以有效应对竞争，则存在盈利能力下滑的风险。

（七）募集资金投资项目实施风险

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目是公司基于当前市场环境、行业发展趋势及自身业务发展规划，经研究与论证后确定。但募投项目的实施需要一定周期，在项目推进过程中，宏观经济政策调整、产业监管政策变动、行业竞争格局变化、市场需求波动等因素均可能发生不利变化，进而对募投项目的实施进度、投入成本及预期收益产生较大影响。本次募投项目聚焦 AI 电源（一次电源、二次电源、三次电源，主要以一次电源为主）、显示类及工业控制领域，上述领域中，三次电源尚未实现批量销售，若未来不能顺利量产，将对募投项目的实施效果与预期效益产生不利影响。此外，在项目实施过程中，若出现募集资金未能按期足额到位、项目实施进度延迟等不确定性事项，亦将对募投项目的实施效果与预期效益带来不利影响。

目 录

声 明 1

重大事项提示 2

一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 2

二、提请投资者重点关注的风险 4

目 录 7

第一节 释义 10

一、常用词汇 10

二、专业词汇释义 10

第二节 发行人基本情况 14

一、发行人基本信息 14

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 15

三、发行人所在行业概况 16

四、发行人主营业务情况 32

五、现有业务发展安排及未来发展战略 52

六、截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资 54

七、同业竞争情况 58

八、未决诉讼、仲裁及行政处罚等相关情况 60

九、报告期内交易所对发行人年度报告的问询情况 61

第三节 本次证券发行概要 64

一、本次发行的背景和目的 64

二、发行对象与发行人的关系 68

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 68

四、募集资金数额及用途 70

五、本次发行是否构成关联交易 70

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 70

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 71

八、本次证券发行满足“两符合”和不涉及“四重大”相关规定 71

九、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的依据及融资间隔相关

情况 73
十、因实施募投项目而新增的折旧和摊销对发行人未来经营业绩的影响 ..74
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 75
一、本次募集资金使用计划 75
二、本次募集资金投资项目的具体情况 75
三、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式 92
四、本次募投项目相关既有业务的发展概况、扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性 95
五、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响 97
六、募投项目实施后新增同业竞争或关联交易的情况 97
七、募集资金投资项目涉及报批事项情况 97
八、募集资金投资项目可行性分析结论 98
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 99
一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 99
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 100
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 101
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 101
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 101
第六节 最近五年内募集资金运用的基本情况 102
一、最近五年内募集资金运用的基本情况 102
二、前次募集资金基本情况 102
三、前次募集资金投资项目实现效益情况 105
四、尚未使用的前次募集资金的后续使用计划 107
五、前次募集资金投资项目变更情况 107

六、闲置募集资金的使用情况 107
七、会计师事务所出具的专项报告结论 108
八、超过五年的前次募集资金用途变更情况 108
第七节 与本次发行相关的风险因素 109
一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 109
二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 112
三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 113
第八节 与本次发行相关的声明 117
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明 117
二、发行人控股股东、实际控制人声明 119
三、保荐人（主承销商）声明 120
四、发行人律师声明 123
五、审计机构声明 124
六、发行人董事会声明 125

第一节 释义

在本募集说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

一、常用词汇

威尔高、公司、本公司、发行人	指	江西威尔高电子股份有限公司
惠州威尔高	指	惠州威尔高电子有限公司，公司全资子公司
泰国威尔高	指	威泰电子有限公司
嘉润投资	指	吉安嘉润投资有限公司，发行人控股股东
本次向特定对象发行/本次发行	指	江西威尔高电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的行为
募集说明书	指	《江西威尔高电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》
定价基准日	指	公司本次向特定对象发行 A 股股票发行期的首日
发行底价	指	本次向特定对象发行定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的 80%
保荐机构（主承销商）、国联民生承销保荐	指	国联民生证券承销保荐有限公司
会计师、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	广东信达律师事务所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》	指	现行有效的《江西威尔高电子股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、最近三年一期	指	2023 年、2024 年、2025 年、2026 年 1-6 月
报告期各期末	指	2023 年末、2024 年末、2025 年末、2026 年 6 月末

二、专业词汇释义

印制电路板/PCB	指	英文全称“Printed Circuit Board”，指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，又可称为“印制线路板”、“印刷线路板”
单面板	指	仅在绝缘基板的一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其

		中一面的 PCB
双面板	指	在基板两面形成导体图案的 PCB
多层板	指	使用数片单面或双面板，并在每层板间放进一层绝缘层后压合的 PCB
刚性板	指	由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板，具有抗弯能力，可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑，又称“硬板”
挠性板	指	用柔性的绝缘基材制成的印制电路板，并具有一定弯曲性的印制电路板，又称“软板”、“柔性板”
厚铜板	指	任何一层铜厚为3OZ及以上的印制电路板
高频高速板	指	在特殊的高频覆铜板上利用普通刚性线路板制造方法的部分工序或者采用特殊处理方法而生产的印制电路板，用于高频率与高速传输领域
HDI 板	指	是高密度互连（High Density Interconnect）印制电路板的简称，也称微孔板或积层板。HDI 是印制电路板技术的一种，可实现高密度布线，常用于制作高精密度电路板
金属基板	指	由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制电路板，具有散热性好、机械加工性能佳等特点，主要应用于发热量较大的电子系统中
封装基板	指	IC 封装载板，直接用于搭载芯片，可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化，缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的
覆铜板/基板/基材	指	Copper Clad Laminate，简称 CCL，为制造 PCB 的基本材料，具有导电、绝缘和支撑等功能，可分为刚性材料（纸基、玻纤基、复合基、陶瓷和金属基等特殊基材）和柔性材料两大类
半固化片	指	又称为“PP 片”或“树脂片”，是制作多层板的主要材料，主要由树脂和增强材料组成，增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型。制作多层印制板所使用的半固化片大多采用玻纤布做增强材料
电镀	指	一种电离子沉积过程，利用电极通过电流，使金属附着在物体表面上，其目的为改变物体表面的特性或尺寸
TG	指	Glass Transition Temperature，玻璃化转变温度，是指由玻璃态转变为高弹态所对应的温度，板材 TG 值越高，表明耐温度性能越好
CPCA	指	中国电子电路行业协会（China Printed Circuit Association）
Prismark	指	美国 Prismark Partners LLC，是印制电路板及其相关领域知名的市场分析机构，其发布的数据在 PCB 行业有较大影响力
微孔板或积层板	指	HDI 板、高密度互连印制电路板
低空经济	指	围绕低空空域资源开发利用，以各类低空飞行器的研发制造、飞行运营、保障服务为核心，带动相关产业协同发展的综合性经济形态，涵盖无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）、通用航空等多个细分领域
具身智能	指	具有身体的智能，其机器大脑能够帮助决策，从而支配肢体能够快速对外部环境变化做出反应

电控	指	电机控制器的简称
AC-DC	指	交流电与直流电之间的转换，在电源技术中，通常指将电网的交流电转换为设备所需的直流电
DC-DC	指	直流电与直流电之间的转换，在电源技术中，通常指将一种电压的直流电转换为另一种电压的直流电，如将高压直流降为芯片所需的低压直流
CAF	指	导电阳极丝测试，评估玻纤增强基材在湿热偏压下的绝缘失效风险（阳极-阴极间金属离子迁移形成短路）
TCT	指	温度循环测试(Thermal Cycling, TCT)，验证 PCB 在温度剧烈变化下的抗疲劳性(如焊点开裂、分层)
埋铜	指	埋铜块、嵌铜，属于 PCB 制造工艺
埋阻	指	埋入式电阻，一种应用于印制电路板中的无源元件技术
埋容	指	埋入式电容，一种应用于印制电路板中的无源元件技术
制程能力	指	又称工序能力或过程能力，是指在生产过程处于稳定受控状态下，产品质量特性值的分布范围能够满足规格要求的能力
Mini LED 光电板	指	是为 Mini LED（次毫米发光二极管） 显示技术专门设计的一种核心电路板
Mini LED	指	Mini LED（次毫米发光二极管），是指芯片尺寸介于 50 至 300 微米（μm） 之间的 LED 器件
平面变压器板	指	平面变压器板，通常指用于构成平面变压器 的印制电路板。平面变压器是一种利用印刷电路板（PCB）技术制造绕组、具有扁平化外形的高频变压器。
光模块	指	又称光收发一体模块，是实现光通信系统中光信号和电信号转换的核心部件，主要由光器件、功能电路和光接口等构成
GPU	指	图形处理器（Graphics Processing Unit，GPU），又称显示核心、显示芯片、视觉处理器，是一种用于处理图像和图形运算工作的协处理器
Laser 微孔技术	指	激光微孔技术（Laser Microvia Technology），是应用高能量激光束，在印制电路板（PCB）的基板材料上精确、高效地加工出微小导通孔（微孔）的先进制造技术。
盲孔电镀填孔技术	指	盲孔电镀填孔技术，是指通过精密控制的电化学沉积过程，用实心铜将印制电路板（PCB）上用于层间连接的盲孔完全填满的一种先进制造工艺。
高精度阻抗控制	指	高精度阻抗控制，是指在印制电路板（PCB）的制造过程中，通过一系列精密的工程设计与工艺管控，将信号传输线的特性阻抗精确地控制在目标值所允许的极小公差范围内。
RCEP	指	《区域全面经济伙伴关系协定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）是由中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰及东盟十国（文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南）共 15 个成员国签署的现代、全面、高水平、互惠的全球最大自由贸易协定。
金盐	指	金盐，学名氰化亚金钾，化学式为 KAu(CN)2，是一种白色结晶或粉末状、有剧毒的含金化合物，主要用于电镀金，是印制电路板（PCB）、连接器、半导体器件等电子工业领域以及珠宝首饰等装饰性镀金的重要化工原料。

金手指	指	金手指是内存条、显卡等电脑硬件上与插槽连接的导电触片组件，由排列如手指状的金黄色触片组成，表面通过镀金或镀锡工艺实现信号传输，具有抗氧化、降低接触电阻的作用。
干膜	指	一种高分子材料，它通过紫外线的照射后能够产生一种聚合反应，形成一种稳定的物质附着于板面，从而实现阻挡电镀和蚀刻的功能
类载板	指	在 HDI 技术的基础上，采用 mSAP 等工艺制程进一步细化线路的新一代精细印制电路板，相较于传统 HDI 线宽线距更小

本募集说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称	江西威尔高电子股份有限公司
英文名称	Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd.
成立日期	2017 年 4 月 7 日（2021 年 8 月 4 日整体变更为股份有限公司）
注册地址	江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号
主要办公地址	广东省惠州市惠城区期湖塘路 5 号惠鹏大厦办公楼 10 楼 1004
法定代表人	邓艳群
注册资本	18,856.4086 万元
统一社会信用代码	91360805MA35UHL002
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	威尔高
股票代码	301251
办公地址邮政编码	516000
电话	0752-6666529
传真	0752-6666529
电子信箱	finance@welgaopcb.com
公司网址	www.welgao.com
经营范围	一般项目：电子元器件制造，电子元器件与机电组件设备制造，光电子器件制造，半导体照明器件制造，电子专用材料研发，集成电路设计，电子元器件批发，电子产品销售，光电子器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，电子元器件零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）股本结构

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股本性质	持股总数（股）	持股比例	其中有限售条件股数（股）
1	吉安嘉润投资有限公司	境内非国有法人	95,200,000	50.49%	95,200,000
2	邓艳群	境内自然人	12,173,728	6.46%	12,173,728
3	陈星	境内自然人	5,600,000	2.97%	5,600,000
4	中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型证券投资基金	其他	4,005,640	2.12%	-
5	香港中央结算有限公司	境外法人	3,420,043	1.81%	-
6	中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金	其他	2,974,100	1.58%	-
7	何明斌	境内自然人	1,840,000	0.98%	-
8	吉安嘉威志成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,780,380	0.94%	-
9	吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,228,220	0.65%	-
10	中国工商银行股份有限公司－新华趋势领航混合型证券投资基金	其他	1,088,559	0.58%	-
合计			**129,310,670**	**68.58%**	**112,973,728**

（二）控股股东及实际控制人

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的控股股东为嘉润投资，持有公司 50.49%的股份；邓艳群及陈星通过嘉润投资控制发行人 50.49%的股份；邓艳群直接持有公司 6.46%的股份；陈星直接持有公司 2.97%的股份；邓艳群及陈星共同控制公司 59.91%的股份，为共同实际控制人。

（三）主要股东所持发行人股份的重大权属纠纷情况

截至 2026 年 6 月 30 日，持有发行人股份 5%以上的主要股东及实际控制人所持发行人股份不存在重大权属纠纷，不存在股份质押的情况。

三、发行人所在行业概况

公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，主要产品包括双面板、多层板，下游主要应用于 AI 服务器电源、工业控制、汽车电子、显示、消费电子、数字通讯等领域。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”之“C3982 电子电路制造”。

（一）所处行业的主要特点

1、行业监管体制和主要法律法规及政策

（1）行业主管部门

中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）是印制电路板行业的主管部门，其主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

（2）行业自律组织

中国电子电路行业协会（以下简称“CPCA”）是行业自律组织，隶属工信部业务主管领导的具有独立法人资格的国家一级行业协会。公司是协会理事单位之一。CPCA 以推进印制电路行业的改革与发展、加速印制电路行业的现代化建设为宗旨，主要职能包括：向政府反映企事业单位的愿望和要求，向企事业单位传达政府的政策和意图，协助政府部门对印制电路行业进行行业管理；向政府部门提出制定行业规划、经济和技术政策、技术标准及经济立法等方面的建议，并参与相应活动；向有关部门和会员单位提供情况、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作等。

（3）最近三年行业主要政策及法律法规

印制电路板在连接各种元器组件中起着关键作用，是现代电子设备的重要

组成部分。电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，印制电路板作为电子信息产业的基础产品，国家相继推出了一系列扶持和鼓励印制电路板行业发展的产业政策，从而推进行业的产业升级及战略性调整。我国支持印制电路板产业发展的有关政策，具体如下：

序号	时间	部门	政策名称	有关内容
1	2026 年 3 月	全国人大	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	统筹推进算力设施建设、模型算法发展和高质量数据资源供给，筑牢数智化发展底座……全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破
2	2025 年 11 月	工信部	《印制电路板行业规范条件》（2025 年）	推动印制电路板产业高端化、绿色化、智能化发展，引导产业加快转型升级
3	2025 年 10 月	中国共产党中央委员会	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
4	2025 年 8 月	工信部	《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》	持续支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制系统等领域科技创新。提升协同攻关效率，支持人工智能、先进存储、三维异构集成芯片、全固态电池等前沿技术方向基础研究。
5	2025 年 4 月	工信部	《电子信息制造业数字化转型实施方案》	重点支持新一代信息通信、集成电路、先进电池材料等作为主导产业的国家高新区及其他重点园区，加快先进计算中心、新一代移动通信、工业互联网等新型基础设施规模化建设应用。深化先进计算、智能控制、人机交互、大数据等技术在人工智能终端产品的应用，加快发展智能传感器、智能移动终端、智能语音交互系统、智能可穿戴设备等。
6	2024 年 2 月	国务院办公厅	《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》	积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受相应支持政策
7	2024 年 1 月	工信部、教育部、科技部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	加快实施重大技术装备攻关工程，突破人形机器人、量子计算机、超高速列车、下一代大飞机、绿色智能船舶、无人船艇等高端装备产品，以整机带动新技术产业化落地，打造全球领先的高端装备体系。深入实施产业基础再造工程，补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺和基础软件等短板，夯实未来产业发展根基。

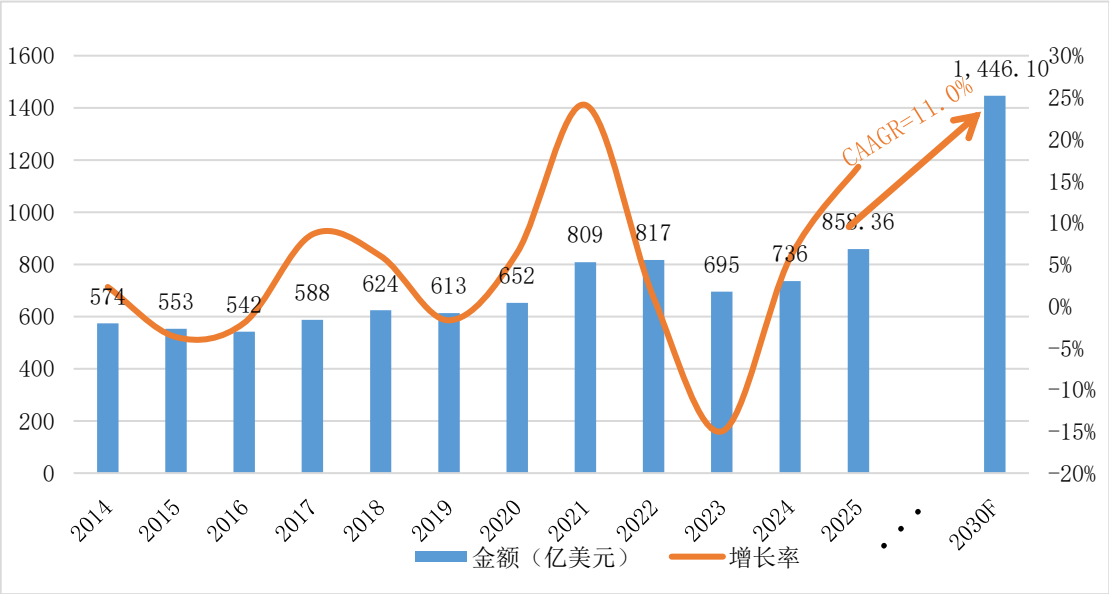
8	2023 年 12 月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	属于鼓励类目录中的“二十八、信息产业·5、新型电子元器件制造：片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器、超级电容器、无源集成元件、高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路（线宽/线距≤0.05mm）柔性电路板、太阳能电池、锂离子电池、钠离子电池、燃料电池等化学与物理电池等”
9	2023 年 11 月	中国算力大会	《中国存力白皮书（2023 年）》	战略上，继续重视数据存储，构建良好的存储行业生态：技术上，全面加快技术创新，推动先进存力的研发部署，产业上，鼓励国产设备应用，提升存力的安全保障能力；标准上，完善产业标准体系，促进产业的健康蓬勃发展。
10	2023 年 10 月	工信部等六部门	《算力基础设施高质量发展行动计划》	强化存力高效灵活保障：加速存力技术研发应用、持续提升存储产业能力、推动存算网协同发展。存储力方面，存储总量超过 1800EB，先进存储容量占比达到 30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到 100%。
11	2023 年 6 月	工信部、教育部、科技部、财政部、国家市场监督管理总局	《制造业可靠性提升实施意见》	聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。提升高频高速印刷电路板及基材、新型显示专用材料、高效光伏电池材料、锂电关键材料、电子浆料、电子树脂、电子化学品、新型显示电子功能材料、先进陶瓷基板材料、电子装联材料、芯片先进封装材料等电子材料性能，提高元器件封装及固化、外延均匀、缺陷控制等工艺水平，加强材料分析、破坏性物理分析、可靠性试验分析、板级可靠性分析、失效分析等分析评价技术研发和标准体系建设，推动在相关行业中的应用。
12	2023 年 2 月	中共中央、国务院	《数字中国建设整体布局规划》	夯实数字中国建设基础。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。
13	2023 年 1 月	工信部等六部门	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	加强面向新能源领域的关键信息技术产品开发和应用，主要包括适应新能源需求的电力电子、柔性电子、传感物联、智慧能源信息系统及有关的先进计算、工业软件、传输通信、工业机器人等适配性技术及产品。

2、行业发展现状和发展趋势

（1）全球印制电路板发展概况

PCB 行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业。2024 年，全球 PCB 产值为 735.65 亿美元。2025 年，受益于 AI 服务器及相关高速网络基础设施推动等因素影响，全球 PCB 产值达到 858.36 亿美元，同比增长 16.7%。

未来在低碳化、智能化等因素的驱动下，服务器、高速网络基础设施等 PCB 下游应用行业预期仍将蓬勃发展，下游应用行业的蓬勃发展将带动 PCB 需求的持续增长。根据 Prismark 预测，未来五年全球 PCB 市场将保持稳定增长的态势，预计 2025 年至 2030 年全球 PCB 产值的年复合增长率达 11.0%，至 2030 年预计全球 PCB 市场将达到 1,446.10 亿美元。2014 年至 2030 年，全球 PCB 行业产值及其变化情况如下图所示：



数据来源：Prismark

①全球 PCB 产业向亚洲特别是中国大陆转移

PCB 产业在全球范围内广泛分布，美欧日发达国家和地区起步早。2000 年以前，美洲、欧洲和日本三大地区占据全球 PCB 产值的 70%以上。但近二十年来，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国大陆、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。随着全球产业中心向亚洲转移，PCB 行业呈现以亚洲，尤其是中国大陆为制造中心的新格局。自 2006 年开始，中国大陆超越日本成为全球第一大 PCB 生产基地，PCB 的产量和产值均居世界第一。

据 Prismark 预测，我国大陆地区将继续保持全球制造中心地位，未来五年

中国大陆 PCB 行业仍将持续增长，预计 2025 年至 2030 年的复合增长率为 10.5%，2030 年中国大陆 PCB 产值将达到 817.64 亿美元。

全球 PCB 产业迁移情况及预计增长率情况如下：

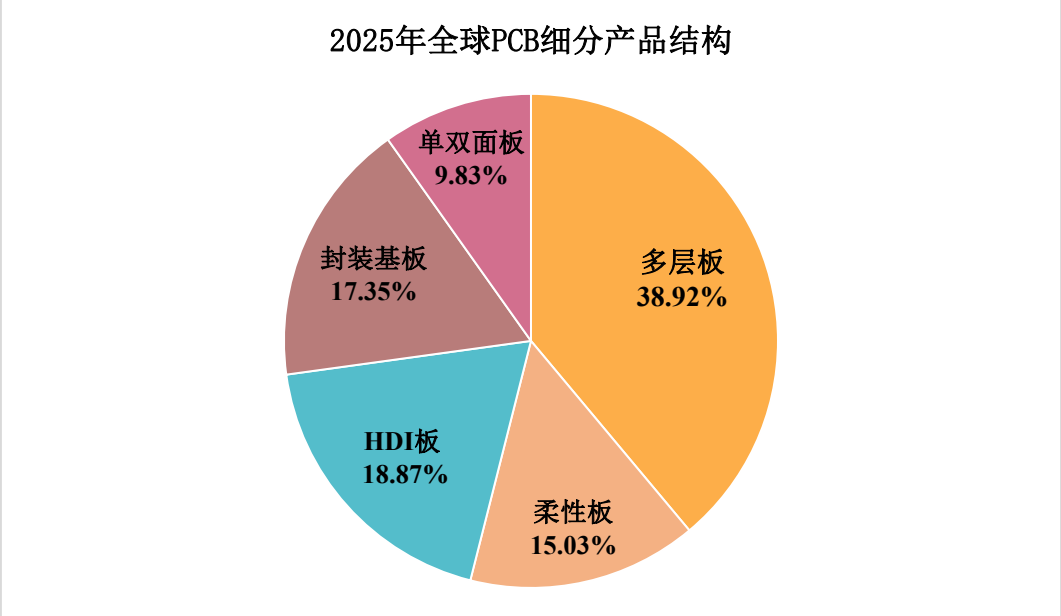
单位：亿美元

国家和地区	2025年	2030F	预计复合年均增长率
中国大陆	496.52	817.64	10.5%
日本	64.99	105.07	10.1%
美洲	37.96	50.81	6.0%
欧洲	17.74	24.96	7.1%
其他地区	241.14	447.62	13.2%
合计	**858.36**	**1446.10**	**11.0%**

数据来源：Prismark

②全球 PCB 产品结构及变化趋势

根据 Prismark 的数据，2025 年全球 PCB 细分产品的市场结构如下：



数据来源：Prismark

从产品结构来看，刚性板占市场主流地位，其中多层板占比 38.92%，单/双面板占比 9.83%；其次是 HDI 板，占比达 18.87%；封装基板和柔性板分别占比为 17.35%和 15.03%。

随着电子电路行业技术的迅速发展，终端应用产品呈现小型化、智能化趋势，市场对高密度、高多层、高技术 PCB 产品的需求将变得更为突出，高多层

板等技术含量更高的产品增长速度将更快，未来在 PCB 行业中占比将进一步提升。根据 Prismark 预测，2025 年至 2030 年全球 PCB 产品细分领域增长情况如下所示：

单位：亿美元

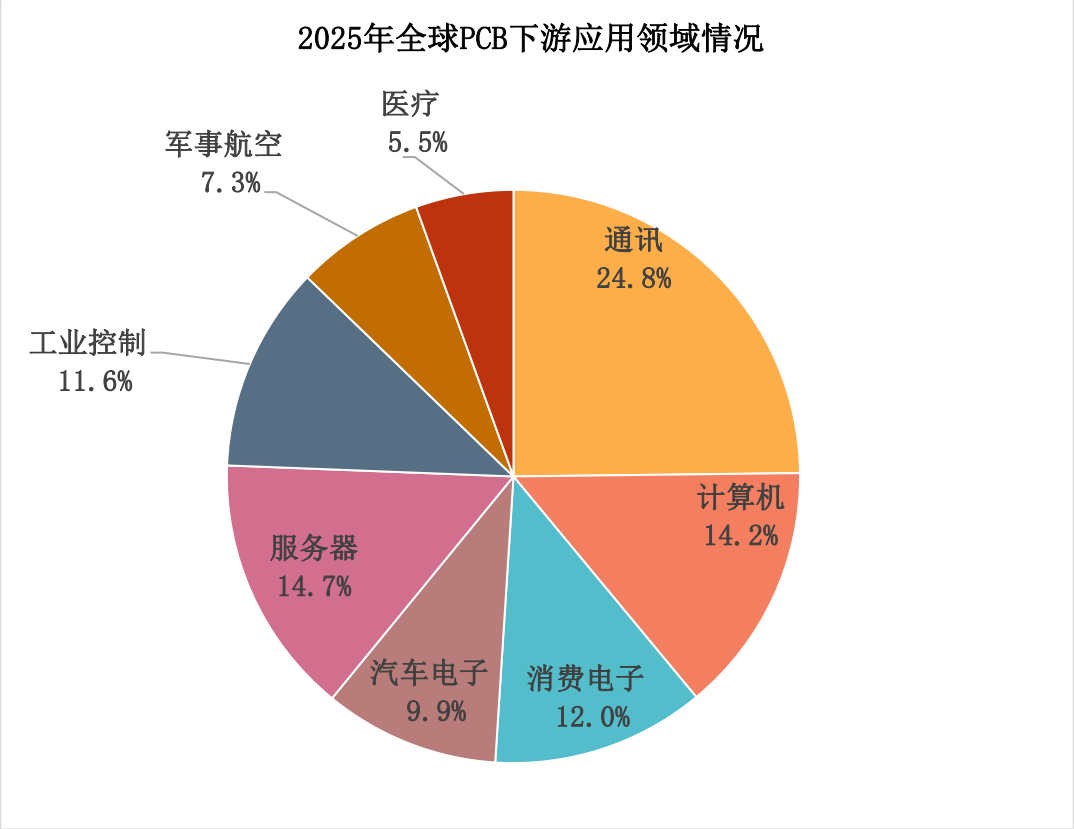
产品类型	2025年	2030F	预计复合年均增长率
单/双面板	84.40	103.44	4.2%
高多层板	334.05	585.63	11.9%
HDI板	161.97	300.10	13.1%
封装基板	148.91	296.10	14.7%
柔性板	129.03	160.83	4.5%
合计	**858.36**	**1,446.10**	**11.0%**

数据来源：Prismark

如上表所示，高端 PCB 产品如高多层板增速较快。未来通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是 PCB 行业长期的重要增长驱动力。为适应不同领域的需求，PCB 正向着高速、高频、集成化、小型化和轻薄化的方向发展，高多层等中高端 PCB 产品将保持强劲增长趋势。

③全球 PCB 下游应用领域

全球 PCB 下游应用领域分布广泛，主要包括通信、计算机、消费电子、汽车电子、服务器、工业控制、军事航空、医疗等领域。根据 Prismark 的统计，2025 年全球 PCB 下游应用领域分布如下：



数据来源：Prismark

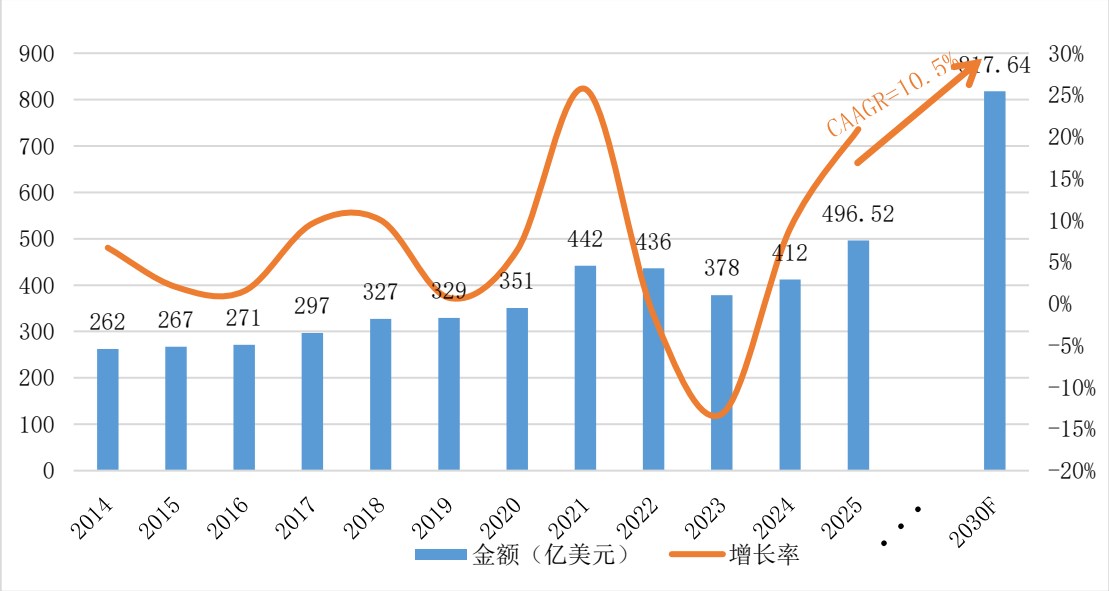
PCB 行业的成长与下游电子信息产业的发展密切相关，两者相互促进。随着大数据、云计算、5G 通信等新一代信息技术的发展，对数据存储和计算力的需求呈高增长态势，服务器行业发展空间广阔。随着新能源汽车的不断普及和汽车电动智能化程度的持续加深，汽车电子行业预计迎来高增长。

（2）中国大陆印制电路板发展概况

①中国大陆 PCB 市场增长迅速，已成为全球最大生产基地

受益于全球 PCB 产能向中国大陆转移以及下游电子终端产品制造业蓬勃发展，中国大陆 PCB 行业整体呈现较快的增长趋势，2006 年中国大陆 PCB 产值超过日本，成为全球第一大 PCB 制造基地。2024 年，中国大陆 PCB 行业产值为 412.13 亿美元。2025 年，PCB 行业迎来结构性复苏，中国大陆 PCB 行业产值为 496.52 亿美元，较上年增长约 20%。

据 Prismark 预测，未来五年中国大陆 PCB 行业仍将持续增长，预计 2025 年至 2030 年复合年均增长率为 10.49%，2030 年中国大陆 PCB 产值将达到 817.64 亿美元。2014 年至 2030 年，中国大陆 PCB 行业产值及其变化情况如下图所示：



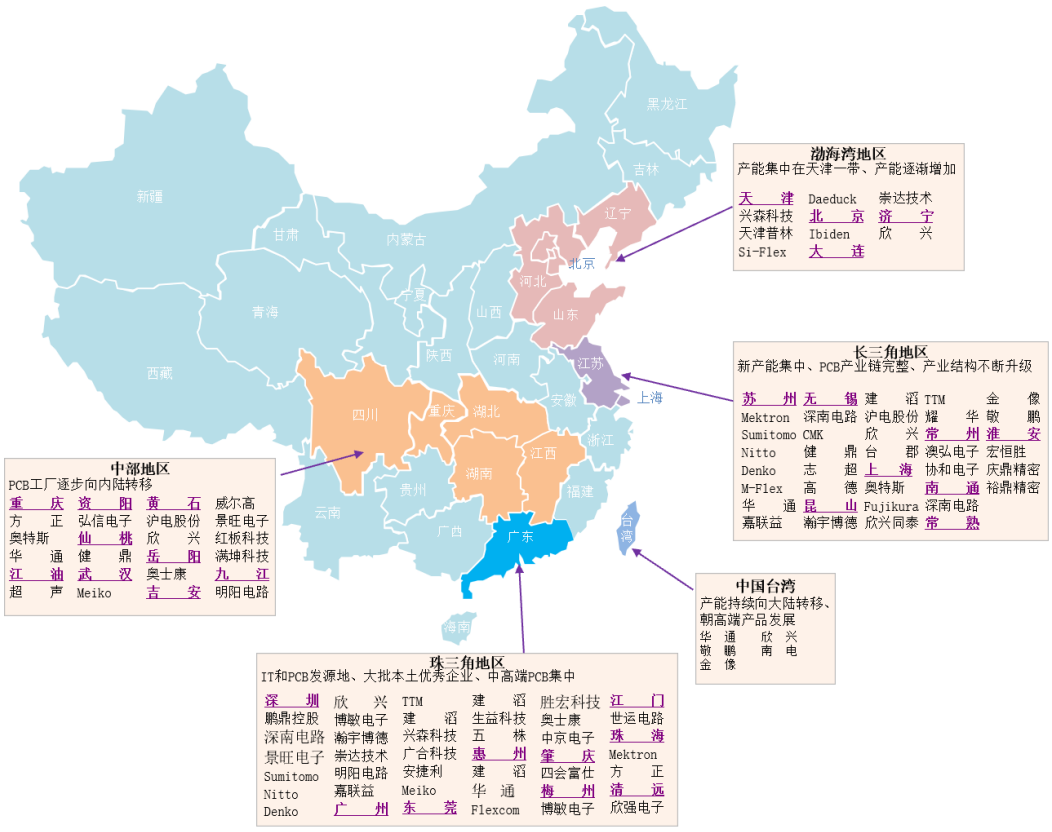
数据来源：Prismark

②中国 PCB 产业区域分布

中国的改革开放从沿海地区起步，沿海地区凭借国家政策支持、便利的基础交通设施、完善的配套产业链以及劳动力优势，成为电子制造行业崛起的试验田，PCB 作为电子制造行业的基础部件，也率先在长三角、珠三角等沿海发达地区起步。近年来，随着长三角、珠三角地区劳动力成本的上升和环保排污指标总量控制等政策，以及内地不断提高的产业链配套服务水平，部分 PCB 生产企业开始将部分产能转移至具备产业链配套条件的内地城市，如江西、湖北、湖南、四川、重庆等地。

江西省作为唯一一个与长三角、珠三角和闽南三角区毗邻的省份，是沿海城市向中部地区延伸的重要地带，在我国产业竞争格局中拥有独特的区位优势和资源优势，加上地方政府大力推动 PCB 相关产业招商引资，电子信息产业集群已初具规模，PCB 产能呈现快速增长的发展势头，江西省逐渐成为沿海城市 PCB 企业主要转移基地。未来中西部地区将有望建立完善的 PCB 产业链，发展成为我国 PCB 行业主要的生产制造基地，同时推动珠三角、长三角地区向高端应用产品和高技术附加值产品发展。

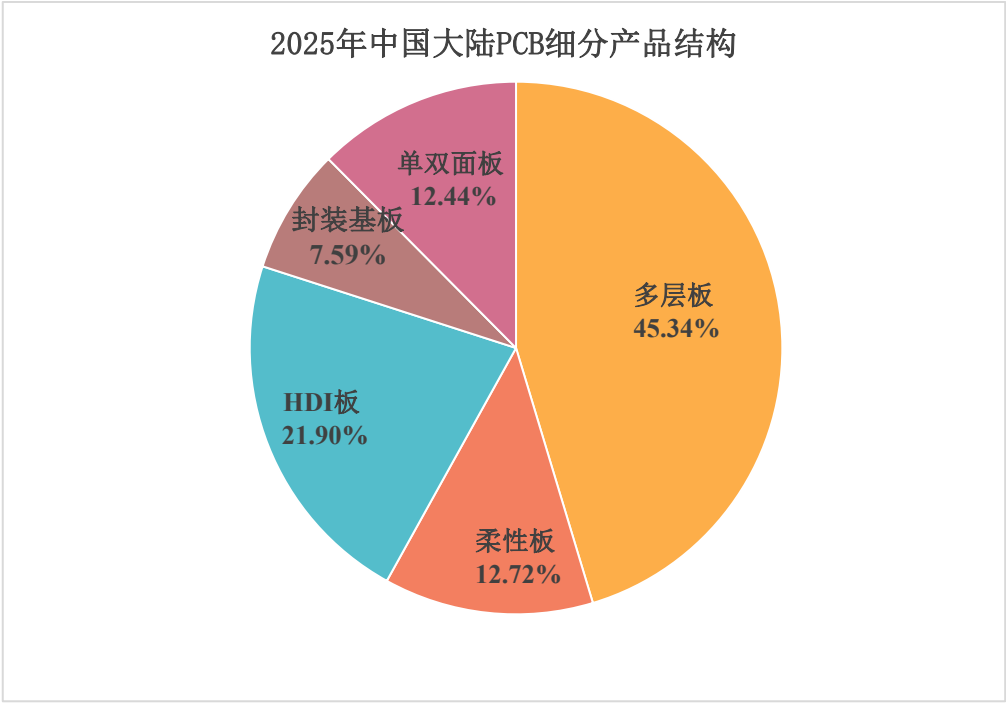
目前，我国主要 PCB 生产商以及其分布如下：



资料来源：公开资料整理

③中国大陆 PCB 细分产品结构

根据 Prismark 的数据，2025 年中国大陆 PCB 细分产品的市场结构如下：



资料来源：prismark

根据 Prismark 数据，2025 年中国大陆刚性板的市场规模最大，其中多层板

占比 45.34%，单/双面板占比 12.44%；其次是 HDI 板，占比达 21.90%；柔性板和封装基板占比分别为 12.72%和 7.59%。

（二）行业竞争情况

1、行业竞争格局及行业内主要企业

（1）全球主要 PCB 企业情况

全球 PCB 行业分布地区主要为中国大陆、中国台湾、日本、韩国和欧美地区，目前中国是全球 PCB 行业产量最大的区域。

全球印制电路板行业集中度不高，生产商众多，市场竞争充分。虽然目前 PCB 行业存在向优势企业集中的发展趋势，但在未来较长时期内仍将保持较为分散的行业竞争格局。根据 Prismark 统计，2025 年全球前十大 PCB 厂商收入合计为 323.91 亿美元。2025 年全球前十大 PCB 厂商的销售情况如下：

2025 年全球前十大 PCB 厂商

单位：亿美元

排名	公司名称	国家/地区	营业收入	基本情况
1	ZD Tech（臻鼎）	中国台湾	58.69	富士康集团成员企业，主营柔性板、HDI 板、刚性板及封装基板
2	Unimicron（欣兴）	中国台湾	42.25	主营封装基板、HDI 板、多层板等
3	Dongshan Precision（东山精密）	中国大陆	35.70	2016 年完成对 FPC 厂商 MFLX 的私有化收购，2018 年完成对伟创力下属 PCB 业务主体 Multek 的收购，目前主营柔性板、刚性板
4	Shennan Circuit（深南电路）	中国大陆	32.95	主营多层板、电子联装、封装基板等
5	TTM Technologies（迅达）	美国	29.06	北美最大的电路板厂商，主营刚性板、HDI 板、柔性板等
6	WUS Group（沪电股份）	中国大陆	27.60	主营单双面板、多层及 HDI 板
7	Victory Giant（胜宏科技）	中国大陆	26.86	主营高端多层板和 HDI 板、柔性电路板
8	Compeq（华通）	中国台湾	24.46	主营多层刚性板、HDI 板、软板与刚柔结合板等
9	Tripod（健鼎）	中国台湾	23.61	主营多层刚性板等
10	Mektec（旗胜科技）	日本	22.73	全球最大柔性板厂商
合计			**323.91**	-

数据来源：Prismark

（2）中国主要 PCB 企业情况

从中国大陆市场来看，PCB 企业大约有 1,500 家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，形成了中国台资、中国港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。其中，外资企业普遍投资规模较大，生产技术和产品专业性都有一定优势；内资企业数量众多，产业集中度低，在规模和技术水平上与外资相比仍存在差距。

根据 CPCA 公布的中国电子电路行业排行榜，2025 年中国主要 PCB 厂商排名如下：

2025 年中国 PCB 企业排名

单位：亿元

序号	公司名称	营业收入	基本情况
1	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	391.47	臻鼎的控股子公司，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在深圳、淮安、秦皇岛和营口
2	苏州东山精密制造股份有限公司	256.20	内资厂商，A 股上市公司，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在苏州、盐城、珠海和昆山
3	深南电路股份有限公司	236.47	内资厂商，A 股上市公司，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，生产基地分布在深圳、无锡、南通、广州
4	胜宏科技（惠州）股份有限公司	192.92	内资厂商，A 股上市公司，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，生产基地分布在惠州、长沙、益阳等地
5	沪士电子股份有限公司	189.45	中国台资控股厂商，A 股上市公司，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在昆山、黄石、常州
6	健鼎科技股份有限公司	153.52	中国台资控股厂商，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在无锡、仙桃
7	深圳市景旺电子股份有限公司	153.08	内资厂商，A 股上市公司，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，生产基地分布在深圳、龙川、江西和珠海
8	华通电脑股份有限公司	125.63	中国台资控股厂商，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在重庆、苏州、惠州
9	欣兴电子股份有限公司	124.06	中国台资控股厂商，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在苏州、昆山、深圳和黄石
10	建滔集团有限公司	122.00	中国港资控股厂商，主营单双面板、多层及 HDI 板
合计		**1,944.80**	

注 1：资料来源 CPCA；

注 2：上表中苏州东山精密制造股份有限公司的营业收入为 PCB 部分，华通电脑股份有限公司、欣兴电子股份有限公司仅包括中国大陆工厂，建滔集团有限公司包含依利安达、

科惠、荣信、扬宣、东阳、建业、万年富。

2、发行人的竞争优势

（1）客户资源优势

由于 PCB 系根据客户的需求提供的定制化产品，知名客户通常对 PCB 品质、寿命、高可靠性要求更为严苛，因此对供应商资质要求高、审核过程长、认证时间久，一旦达成合作，基于对技术要求、产品质量、采购成本等多方面综合考虑，一般会与供应商形成长期合作关系。不同的下游应用领域对 PCB 的技术要求不同，在特定领域获取品牌客户证明在该领域公司的产品质量值得信赖、技术水平先进，形成独有的竞争优势。

公司良好的产品性能和品质表现获得了客户的高度认同，与台达电子、施耐德、三星电子、冠捷科技、比亚迪、长城电源、欧陆通股份、富士康等客户建立长期战略合作关系，并多次获得颁发的奖项，在行业内形成了良好的客户口碑。优质的品牌客户资源提高了公司的品牌形象，持续获得稳定的业务订单，并能有更多新的业务合作机会和新的市场空间。

近几年，随着 AI 驱动下产品迭代升级加速，威尔高依托多基地的技术研发与快速量产优势，与客户深度绑定，共同开发新产品、研究新材料。从 GB200、GB300 到 Rubin 的量产落地，公司技术能力与市占率不断提升。

（2）产品质量优势

公司从物料选择、工艺流程管控到产品检测等全方面严格监管品质，形成了自身的产品质量优势，得到了客户的广泛认可。公司通过产品的研发和工艺技术优化，在生产过程中持续提升、完善生产工艺技术能力，最大化满足客户产品的特殊工艺要求，积累了多项生产工艺技术，以持续的科研投入进行技术、制程能力储备，确保了品质基石稳定。

（3）生产交付优势

公司具备柔性生产优势，贴合终端客户的差异化需求。随着公司泰国工厂投产，公司拥有三个生产基地，分别是位于大湾区的惠州工厂、毗邻珠三角和长三角的江西吉安工厂及一带一路的东南亚泰国大城府泰国工厂。根据客户对产品、品质、技术、交期等要求，充分发挥各工厂的优势，通过对生产资源的

评估和分配，保证客户的满意度和差异化需求。

惠州工厂专注小批量、多品种、厚铜板等高附加值产品生产；江西工厂依托智能化专业生产线，实现自动化、智能化、数字化生产，具备中大批量快速交付能力；泰国工厂作为东南亚制造基地，为“一带一路”沿线国家提供前沿一体化制造解决方案。

（4）核心技术优势

围绕 AI 数据中心供电架构对 PCB 提出的高散热、高可靠、高集成的需求，公司在诸如厚铜 HDI 板的相关产品上已积累了领先的技术工艺优势。

厚铜板的技术难点主要聚焦于蚀刻、层压、钻孔、电镀等环节，其中层压结合力与平整度是关键难题。厚铜与半固化片（PP）在高温高压条件下流动填充困难，容易产生缺胶、空洞、分层等问题，进而影响层间结合力与绝缘性能；与此同时，厚铜与基材的热膨胀系数差异显著，在冷热循环过程中容易积累应力，从而导致板面翘曲，在多层板压合时这一问题表现得更为突出。当铜厚从 1oz 增加到 3oz 时，翘曲概率可达普通板的 4 倍。

针对层压结合力与平整度这两大核心难题，从设计仿真、设计图形的残铜率、拼版方式、材料配方、工艺参数、全流程运输载具优化到设备定制化改造等多个维度进行了持续攻关。通过引入先进的仿真模拟技术，精确分析厚铜与 PP 片在层压过程中的流动特性和界面反应机制，成功开发出具有自主知识产权的低流动高填充 PP 材料以及梯度升温加压层压工艺，有效解决了缺胶、空洞和分层问题，显著提升了层间结合力以及提升了产品整体可靠性。同时，通过对基材选型进行优化，并结合特殊的刚性固定与热应力释放设计，大幅改善了厚铜板的翘曲现象，确保了产品在不同温度环境下的尺寸稳定性。

目前公司掌握 4-12oz 厚铜高多层产品的批量生产能力，针对 12oz 以上超厚铜高多层板的加工工艺亦完成研发储备；DC-DC 产品上突破 30L 产品技术壁垒，通过对高散热材料的研究测试，特殊埋铜、埋阻、埋容工艺的导入，助力 DC-DC 高端电源模块实现批量生产。

公司的核心技术在生产制造过程中予以充分验证，覆盖 PCB 生产制造的全流程，涉及新产品的开发、生产技术的更新和工艺技术的改进等，是公司持续

开发新产品、获取客户订单资源、保持业务增长的重要基础。将核心技术应用至产品生产之中，例如将精细线路碱性蚀刻方法、PCB 钻孔偏移检测方法、PCB 板阻焊层剥离技术、PCB 板干膜显影技术应用于蚀刻、钻孔、阻焊、显影工序等。

3、影响行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

①产业政策支持

电子信息产业是我国重点发展的战略性支柱产业，印制电路板行业作为电子产品的基础产品，受到国家政策的大力支持。我国先后通过出台《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等政策方针，把 PCB 行业相关产品列为重点发展对象。“十五五规划”提出全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。国务院及相关部委推出了“新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）”、“电子信息制造业数字化转型实施方案”、“电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案”等一系列产业政策支持和引导 5G 通信、新能源汽车、物联网、工业互联网等领域的发展。国家政策的扶持将为电子信息产业提供广阔的发展空间，推动了 PCB 行业的发展，助力电子制造业全面转型升级，国内 PCB 行业将借此契机不断提升企业竞争力。

②下游应用领域的不断发展

印制电路板的下游行业广泛，主要包括通信、计算机、服务器、消费电子、汽车电子、工业控制、军事航空、医疗等领域。广泛的应用分布为印制电路板行业提供巨大的市场空间，降低了行业发展的风险。近年来，在人工智能技术驱动下，服务器等算力基础设施快速扩张，AI 服务器、高性能计算与网络通信设备开启新一轮 AI 技术创新周期，叠加汽车电动化与智能化进程加速、5G 通信以及智能制造等新技术与新产品带来的发展红利，HDI 板、高多层板、封装基板等高端 PCB 产品需求随之快速增长，行业整体景气度保持上行趋势。PCB 应用行业的技术革新及新兴产业的发展为 PCB 行业带来了广阔的市场空间，为

PCB 市场发展提供了重要支撑。

③中国电子行业产业链完整

近年来，中国电子信息产业一直保持快速发展，带动了中国电子信息产业链的发展。目前，中国电子信息产业链已日趋完整，国内电子行业规模大、配套能力强，产业集聚效应明显。中国印制电路板行业上游行业发展迅速，主要原材料如覆铜板、半固化片、铜箔等厂商具备充分生产供应能力，能快速响应 PCB 企业的需求。且在高端原材料领域，国内企业已实现突破，在高速覆铜板用的树脂方面，国内已有企业可提供 M6 至 M8 全系列产品，并进入主流供应链；在高端铜箔领域，国内厂商已具备 HVLP1-4 代的生产能力，并正向 HVLP5 技术攻关；在低介电常数玻纤布（Low-Dk 布）方面，国内龙头企业已实现量产并积极扩产，能满足高附加值、高技术难度产品的市场需求。

PCB 行业作为电子信息产业的基础行业，在产业链中起着承上启下的关键作用，完整的产业链使 PCB 企业既能快速采购原材料，又能快速响应客户需求，保障 PCB 产业稳定发展。

④全球产能继续向中国大陆等地区转移

近二十余年，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子信息产业产能向中国大陆、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。随着全球产业中心向亚洲转移，PCB 行业呈现以亚洲，尤其是中国大陆为制造中心的新格局。自 2006 年以来，中国超越日本成为全球第一大 PCB 生产国，PCB 的产量和产值均居世界第一。以长三角和珠三角为代表的中国大陆电子信息产业规模大、产业链完整、配套能力强，产业集聚效应明显。目前，中国大陆 PCB 产品呈现量大但技术含量较低的特点，随着中国大陆 PCB 企业的不断发展，预计未来全球 PCB 产能尤其是中高端 PCB 产能向中国大陆转移的趋势仍将持续。

（2）不利因素

①市场竞争加剧

全球 PCB 行业竞争格局较为分散，生产厂商众多，市场竞争较为充分，行业格局正朝着“大型化、集中化”方向发展，中小 PCB 企业面临更大生存压力。

在 AI 终端、服务器、高速通信、智能汽车电子等新兴高端领域，由于对 PCB 的层数、材料、工艺提出了极高要求，技术壁垒和资金壁垒陡增，国内主流 PCB 厂商正在增加资本开支，积极扩充高端产能，众多 PCB 厂商的加速切入，可能导致行业供给格局在未来趋于拥挤，未来 PCB 市场可能存在行业产能扩张规模过大导致竞争进一步加剧。

②原材料价格波动

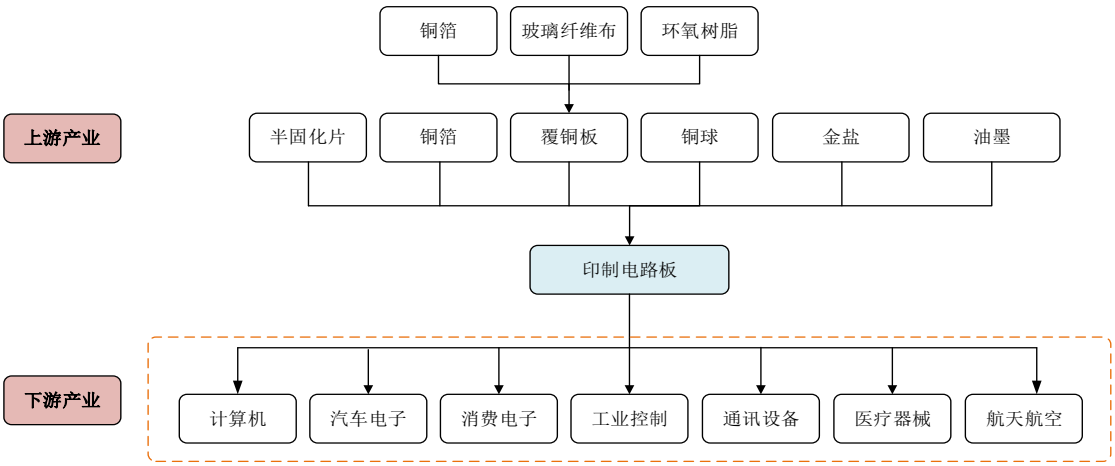
受市场供求关系等因素的影响，PCB 企业根据原材料价格的变化调整 PCB 销售价格的时间和幅度可能受限。原材料价格的波动为 PCB 企业控制成本和提高盈利能力带来了一定的挑战。因此原材料价格的波动会对 PCB 企业的盈利能力产生影响。

③环境保护要求不断提高

当前政府主管部门对企业环境保护的要求不断提升，相关法律法规的标准保持从严趋势，执法力度不断加大，舆论监督的关注度也在不断提高，一方面带动了企业环境保护水平的提高，有利于经济的可持续发展，另一方面也增加了企业的前期投入和生产成本，使企业面临更大的竞争压力。

4、上下游行业情况

PCB 行业上游为生产所需的原材料，主要包括覆铜板、半固化片、铜球、铜箔、金盐、油墨等。下游行业主要包括通讯、计算机、消费电子、汽车电子、服务器、工业控制、军事航空、医疗等领域。印制电路板行业上下游联系紧密，上下游的关系如下图所示：



（1）上游行业对 PCB 行业的影响

从行业整体水平来看，原材料成本占 PCB 生产成本的一半以上，上游原材料的供应情况和价格水平对 PCB 企业的生产成本产生重大影响。我国 PCB 的上游配套产业发展成熟，供应充足且竞争较为充分，能够满足 PCB 行业的发展需求。

PCB 所使用的主要原材料中，覆铜板主要担负着 PCB 导电、绝缘、支撑三大功能，其性能直接决定 PCB 的性能，是生产 PCB 的关键基础材料，占直接材料成本比重最高。除了覆铜板以外，铜球和铜箔也是 PCB 生产的重要原材料。覆铜板、铜球和铜箔等原材料均是以铜作为基础材料，其价格受铜价影响较大。因此，铜价的变动会影响原材料的价格，并进一步影响 PCB 生产成本。

（2）下游行业对 PCB 行业的影响

PCB 行业下游为各类电子信息产品，产品应用覆盖通讯电子、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天以及军事等领域。PCB 行业与下游行业已形成相互促进、共同发展的双赢关系。根据 Prismark 的统计和预测，2025 年，受益于 AI 服务器、人工智能、高速通信、数据/存储、算力设施、智能驾驶及相关高速网络基础设施推动等，全球 PCB 产值达到 858.36 亿美元，同比增长 16.7%。未来五年全球 PCB 市场将保持稳定增长，2025 年至 2030 年全球 PCB 产值的预计年复合增长率达 11.0%，至 2030 年预计全球 PCB 市场将达到 1,446.10 亿美元。

PCB 市场需求与电子信息产业整体发展情况具有较强的相关性。近年来随着全球科学技术飞速发展，5G、新能源汽车、Mini LED、人工智能等新的科技热点不断涌现，带动全球电子信息产业持续增长，从而促进了 PCB 产业的发展。在科技热点的带动下，未来全球的电子信息产业仍将保持增长的势头，为 PCB 产业发展带来广阔的市场空间。与此同时，下游应用领域的技术发展会推动 PCB 产品的技术发展，以适应终端产品的市场需求。

四、发行人主营业务情况

（一）主要产品及其用途

1、公司的主营业务

公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，主要产品包括双面板、

多层板，下游主要应用于 AI 服务器电源、工业控制、汽车电子、显示、消费电子、数字通讯等领域。

自成立以来，公司的主营业务没有发生变化。

2、公司主要产品及其用途

（1）主要产品

公司主要产品为印制电路板，公司产品按照层数可分为双面板和多层板。

①双面板

双面板采用一张覆铜板作为绝缘基板，在绝缘基板的两面具有导电图形的印制电路板，由于两面都有导电图形，需通过导孔将两面的线路连接。

②多层板

多层板是有四层及以上导电图形的印制电路板，内层由导电图形与绝缘材料压制而成，外层为铜箔，层间导电图形通过导孔进行互连，可用在复杂电路中。多层板相较于双面板增加了压合、内层线路等工序，工艺流程更为复杂，技术要求更高。

（2）产品下游应用领域

公司产品下游应用领域广泛，主要应用于 AI 服务器电源、工业控制、汽车电子、显示、消费电子、数字通讯等领域。

①AI 服务器电源

AI 服务器电源是专为 AI 服务器设计的核心供电组件，负责将电网的交流电高效、稳定地转换为 GPU、CPU 等核心芯片所需的低压直流电。AI 大模型训练与推理推动算力密度急剧提升，AI 服务器单机柜功率持续提升，相关供电架构在转换效率、占地面积、散热能力与动态响应等方面正在经历全方位升级，从而对相关 PCB 产品的可靠性、耐热性提出了更高的要求。公司产品主要应用于 PSU、Power Shelf、PMC 等 AC-DC 电源之中，并已陆续拓展至 IBC、PDB、VRM、HVDC，VPD、IVR 等 DC-DC 电源，代表客户包括台达电子、立讯精密、沛塬电子、欧陆通、长城电源、麦格米特、新雷能等国内外头部电源厂商。

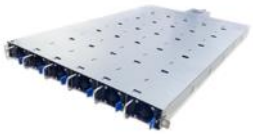
公司产品主要性能指标如下：

项目	AC-DC	DC-DC
层数	2-10 层	16-30 层
板厚	1.2MM-5.0MM	0.6MM -8.0MM
材料	FR4、高 TG	FR4、高 TG、高 CTI、高 MOT
特殊工艺	32u″金手指	超厚铜、控深钻、BGA 平整度
铜厚	2oZ-4oZ	2oZ-12oZ
电性能要求	400V-3000V	1000V-6000V

公司产品在 AI 服务器电源领域的主要应用如下：



电源供应单元PSU



电源架PowerShelf



DC/DC模块电源

②工业控制

工业控制是指利用电子电气、机械和软件实现工业自动化，使工厂的生产和制造过程更加自动化和精确化，并具有可视可控性。工业控制产品需要技术和工艺水平高的 PCB 产品，是细分领域的高端市场。公司产品主要应用于工业电源、变频器、伺服器、断路器等，代表客户包括施耐德（Schneider）、台达电子（2308.TW）、禾川科技（688320.SZ)、伟创力（Flex）等知名产品制造商。

公司产品主要性能指标如下：

项目	工业控制 PCB
层数	2-16 层
尺寸（板厚）	75*75mm-480*560mm（板厚：1.0-3.2mm）
材料	FR4、普通 TG、高 TG、无卤素
特殊工艺	正片、板边镀铜、POFV 工艺、电感测试
电性能要求	耐高压（DC 4000v）（孔铜≥25μm）

公司产品在工业控制领域的主要应用如下：



人形机器人



变频器



断路器

③显示

市场上目前主流的显示技术包括 LCD、OLED 和 Mini/Micro LED，公司 PCB 产品主要应用于 Mini LED 和 LCD。LCD 发展历史较为悠久，是目前市场上主流的显示技术。Mini LED 是指晶粒尺寸约在 100 微米的 LED，具有轻薄、高画质、低功耗等特性，适用于车载显示、户外显示屏、大尺寸电视等领域，被视为新一代的显示技术。在显示领域，公司代表客户包括三星电子（SAMSUNG）、冠捷科技（000727.SZ）、瑞丰光电（300241.SZ）、聚飞光电（300303.SZ）等产品制造商。

公司产品主要性能指标如下：

项目	显示 PCB
层数	2-8 层
尺寸（板厚）	75*75mm-480*560mm（板厚：0.4-1.6mm）
材料	FR-4
特殊工艺	灯珠尺寸 100-400μm（+/-15%），LDI（外层）/DI（防焊）（黑色/白色油墨），反射率≥85%，黄变值 B≤2
电性能要求	阻抗公差±8-10%、耐 500 小时 CAF 测试

公司产品在显示领域的主要应用如下：



车载显示屏



户外显示屏



大尺寸电视

④消费电子

消费电子板主要应用于手机及其配套设备、智能家居及办公设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的电子产品。随着信息时代的发展，消费电子中的主板既要承载更多信息量以及保持更快传输速率，又要保持其体积的微小。

公司消费电子 PCB 产品应用终端包括手机快充电源、智能家居、智慧教育、电脑周边、无人机等，代表客户包括立讯精密（002475.SZ）、拓邦股份（002139.SZ）、盈趣科技（002925.SZ）、奋达科技（002681.SZ)、奥海科技（002993.SZ)等产品制造商。

公司产品主要性能指标如下：

项目	消费电子 PCB
层数	2-14 层
尺寸（板厚）	75*75mm-200*300mm（板厚 0.6-3.2mm）
材料	FR4（普通 Tg、中 Tg、高 Tg、无铅、无卤）
特殊工艺	化金+OSP、喷锡+电金手指
电性能要求	阻抗公差±8-10%

公司产品在消费电子领域的主要应用如下：



手机快充



智能家居



无人机



智慧教育

⑤通讯设备

通讯设备板具有高频、高速的特点，主要应用于路由器、机顶盒、交换机、通信基站有线或无线网络传输的通信基础设施。随着 5G 网络建设的大规模推进及商用，全球将迎来新一轮科技革命和产业变革，5G 与云计算、大数据、物联网等技术的深度融合，将推动通讯设备相关技术和应用更快发展、迭代、融合，对通信设备 PCB 提出更多的技术挑战和要求。

公司通讯设备产品主要应用于路由器、高端交换机主板、通信电源、光模块等，代表客户包括星网锐捷（002396.SZ)、泰科电子（TEL.NYSE）、亿思源光电、网是科技等产品制造商。在光模块领域，公司通过持续研发，实现了阻抗±5%的高标要求，同时在 PCB 整板尺寸、金手指间距尺寸满足了±0.03mm 的公差要求，能够保证在光传输中信号的准确性及完整性。

公司产品主要性能指标如下：

项目	通讯设备 PCB
层数	4-26 层
尺寸（板厚）	100*100mm-560*700mm（板厚 0.6-3.2mm）
材料	中高 TG FR-4、高频板材、高速板材（M7、M8）
特殊工艺	多种材料混压、PTH 半孔、背钻工艺、控深锣、POFV
电性能要求	阻抗公差±5%、插损控制

公司产品在通讯设备领域的主要应用如下：



路由器



交换机



光模块

（二）主要经营模式

1、研发模式

在研发创新方面，公司设立了研发技术中心，建立了完善的研发体系，进行新产品、新技术、新工艺的开发研制，不断提升生产效率、优化产品结构。技术研发中心组负责新产品、新工艺进行研发，并对生产、研发过程中遇到的技术难题进行技术攻关；产品规划组负责对新产品线导入的相关新产品的技术资料，技术指标项目、可靠性测试项目要求、加工过程控制难点及要点进行策划；品质组负责为研发活动提供先进的试验检测方法与手段。公司新项目的研发流程主要包括立项、方案设计、样品测试、小批量加工、批量生产五个阶段。同时研发技术中心推行 N+1 的研发模式，在现有的新产品及新工艺技术研发基础上推行预研一代生产一代、不断优化迭代加工方法及参数，做到资源最大化，紧跟客户及市场需求，与客户形成长久且稳固的商业合作伙伴关系。

另外，公司通过研发技术中心的优势，不断扩大研发需求，在技术人才培育培养推行内外兼修：内部推行技术人员技能提升、考核等方式，让全员参与技术开发，有效的推行降本增效，让公司获取更多收益。外部推行与各重点高

校合作，引入 211/985 等应届毕业生进行人才的迭代，不断的给公司输送有价值的血液。

2、采购模式

公司结合生产计划及现有库存情况安排采购计划，主要原材料的采购根据公司现有订单需求进行采购，辅料则是每月按照近期平均使用量进行采购，主要原材料包括：覆铜板、铜箔、铜球、金盐、半固化片、干膜等，辅料包括化学药水、钻头、铣刀等。在供应商选择时，公司会对供应商进行资质审查，对其经营资质、生产和技术能力、产品质量、供货及时性、服务质量、环境保护等方面进行综合考量，经审核后，将符合要求的供应商列入合格供应商名录。

3、生产模式

印制电路板为定制化产品，公司实行“以销定产”的生产组织模式，公司根据客户订单、交期安排生产，计划部根据订单情况制定相应的生产计划，生产部依据生产计划组织生产，生产流程如下：（1）业务部接到客户订单时，首先进行订单评审。如涉及新产品，则由工程部、工艺部负责公司新产品的开发及样品生产；（2）计划部根据订单计划、交期安排、产能情况制定生产安排计划。若公司的某工序产能无法满足生产投入计划，则通过《合格供应商名录》寻找外协加工厂商进行委外加工；（3）生产部依据每日生产计划表，管理、执行订单的生产进度，发现有延误及需要调整进度的订单时，及时指示调整，与客户及时沟通。在生产过程中，公司采取全员检查的方式，每道工序的作业员都对产品质量进行在线检查，同时品质部的人员也会对产成品的外观、品质进行检测，产品出货前会进行铜厚检测、阻抗检测、热冲击等抽检试验，检验合格后交付给客户。

4、销售模式

（1）销售体系：公司具有完整的销售业务体系，充分以客户为中心，根据销售地区进行分组，国内、国外建立多个销售办事处，并配有专业的技术、品质、服务人员团队支持，全方位挖掘及满足客户需求，增强市场占有率。

（2）客户类型：公司客户类型可分为生产商和贸易商，根据公司客户类型和国内外市场的特点，公司主要采用直销的销售模式，产品直接销售至国内外

电子产品制造商，少量通过贸易商进行销售。

（3）业务发展：以电机、电控、电源为产品方向，持续深化市场渗透，在工业控制、汽车电子、服务器电源、二次电源、数字通讯等关键领域获得了新老客户的广泛认可，并逐步提高市场份额，深化在细分市场中的领导地位；并以泰国工厂最早投产且最先稳定量产为契机，紧紧抓住 PCB 产业转移机会，不断向海外知名企业拓展市场，以 AI 产品为方向，向数字基建层、产品应用层不断研发推广新产品，深度参与国际前沿项目，从而有效提升公司国际市场声誉；中国市场以江西工厂二期投入建设扩大产能为机会，抓住 AI 人工智能、国内提振消费、扩大内循环的政策利好局面，通过跟战略客户进行技术研发绑定，扩大国内细分领域市场的销售占比率及市场份额，让国内同国外市场双驱动，引领集团快速前行。

（三）营业收入情况

1、营业收入的构成情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	86,857.68	88.68%	134,287.34	86.96%	90,789.83	88.87%	74,587.76	90.66%
其他业务	11,086.94	11.32%	20,143.31	13.04%	11,374.38	11.13%	7,681.29	9.34%
合计	**97,944.62**	**100.00%**	**154,430.66**	**100.00%**	**102,164.21**	**100.00%**	**82,269.05**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入金额分别为 74,587.76 万元、90,789.83 万元、134,287.34 万元和 86,857.68 万元。公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 90.66%、88.87%、86.96%和 88.68%，公司主营业务突出。

2、主营业务收入构成情况

报告期，公司按产品类型划分的主营业务收入结构情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
双面板	20,536.10	23.64%	41,303.26	30.76%	41,026.72	45.19%	30,750.74	41.23%

多层板	66,321.58	76.36%	92,984.08	69.24%	49,763.11	54.81%	43,837.02	58.77%
合计	**86,857.68**	**100.00%**	**134,287.34**	**100.00%**	**90,789.83**	**100.00%**	**74,587.76**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入呈不断上升趋势，其中多层板占主营业务收入比重分别为 58.77%、54.81%、69.24%和 76.36%，2025 年度和 2026 年 1-6 月多层板销售占比持续提高，主要系公司持续加大对高端产品市场的开拓力度，优化公司产品结构导致。

（四）主要产销量情况

报告期内，公司产品的产能、产量和销量情况如下：

单位：万平方米

项目	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
产能	131.94	245.71	212.84	198.47
自产产量	119.75	223.38	185.75	142.05
销量	113.11	217.71	182.39	137.31
产能利用率	90.76%	90.91%	87.27%	71.57%
产销率	94.46%	97.46%	98.19%	96.67%

注：产能利用率=自产产量/产能；产销率=销量/自产产量。

报告期内，公司的产能、产量、销量均逐年增长，产能利用率整体呈上升趋势。

报告期内，公司的产销率较高，主要系公司采取“以销定产”的生产模式，根据客户的订单来组织生产，产品产销率均处于较高水平。

（五）主要原材料采购及能源供应情况

公司主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、金盐等，公司产品所用原材料种类及型号较多，上游行业技术较为稳定、产品较为成熟、供应量充足、市场充分竞争，主要供应商与公司长期合作，供货及时。

公司生产中耗用的能源主要为电。报告期，公司消耗的电费、耗电量、电价情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
电费（万元）	5,457.79	9,659.73	7,357.49	5,415.11
耗电量（万度）	8,449.15	14,061.16	10,682.60	7,899.78
电价（元/度）	0.65	0.69	0.69	0.69

报告期内，发行人电费呈上涨趋势，与公司产量增长情况相匹配。

（六）与业务相关的主要固定资产和无形资产

1、固定资产基本情况

公司的固定资产主要包括：房屋建筑物、机器设备、运输设备等。截至报告期末，公司固定资产原值为 155,945.63 万元，账面价值为 118,237.65 万元，具体情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	67,169.46	10,508.79	56,660.68	84.35%
机器设备	86,450.43	25,805.65	60,644.79	70.15%
运输设备	622.22	318.20	304.02	48.86%
电子设备及其他	1,703.52	1,075.34	628.18	36.88%
合计	**155,945.63**	**37,707.98**	**118,237.65**	**75.82%**

2、无形资产基本情况

发行人无形资产主要包括土地使用权、境外土地所有权、软件。截至报告期末，公司无形资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	期末余额	累计摊销	账面价值
土地使用权	1,464.30	245.75	1,218.56
境外土地所有权	4,698.54	-	4,698.54
软件	658.91	289.92	368.99
合计	**6,821.75**	**535.66**	**6,286.09**

注：泰国威尔高在泰国购买土地，拥有土地永久产权，未进行摊销。

3、土地使用权及房产情况

截至报告期末，发行人及其下属子公司拥有的土地使用权及房产情况如下表所示：

（1）土地使用权情况

截至报告期末，公司及其下属子公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	所有权人	证书编号	地理位置	面积（㎡）	取得方式	终止日期	是否抵押
1	威尔高	赣（2022）井开区不动产权第 0000021 号	井开区永锦大道与南塘路交叉口西南角地块	27,039.00	出让	2072 年 1 月 5 日	是
2	威尔高	赣（2021）井开区不动产权第 0003264 号至 0003268 号同为一宗土地	吉安市井开区永锦大道 1 号	115,271.00	出让	2067 年 9 月 24 日	是
3	惠州威尔高	博府国用（2009）第 040009 号	麻陂镇龙苑工业区	15,370.00	出让	2054 年 6 月 21 日	是
4	泰国威尔高	43771	泰国大城府洛加纳大城工业区	85,299.60	受让	永久（土地使用权）	是
5	泰国威尔高	44115	泰国大城府洛加纳大城工业区	4,800.00	受让	永久（土地使用权）	否

（2）房屋建筑物情况

截至报告期末，公司及其下属子公司已取得的房屋的所有权具体情况如下：

序号	所有权人	不动产权证号	房屋坐落位置	建筑面积（m^2）	取得方式	房屋用途	是否抵押
1	威尔高	赣（2021）井开区不动产权第 0003264 号	井开区永锦大道 1 号	31,690.58	自建	工业	是
2	威尔高	赣（2021）井开区不动产权第 0003267 号	井开区永锦大道 1 号	51.23	自建	工业	是
3	威尔高	赣（2021）井开区不动产权第 0003266 号	井开区永锦大道 1 号	7,731.33	自建	工业	是
4	威尔高	赣（2021）井开区不动产权第 0003268 号	井开区永锦大道 1 号	1,299.87	自建	工业	是
5	威尔高	赣（2021）井开区不动产权第 0003265 号	井开区永锦大道 1 号	6,944.24	自建	工业	是
6	惠州威尔高	粤房地权证字第 DJ00130491 号	博罗县麻陂镇龙苑工业区	4,693.59	自建	工业	是
7	惠州威尔高	粤房地证字第 C6985421 号	博罗县麻陂镇龙苑工业区	4,211.78	自建	厂房	是
8	惠州威尔高	粤房地证字第 C6985422 号	博罗县麻陂镇龙苑工业区	43.92	自建	其他	是
9	惠州威尔高	粤房地证字第 C6985423 号	博罗县麻陂镇龙苑工业区	174.66	自建	工业仓储	是
10	惠州威尔高	粤房地证字第 C6985424 号	博罗县麻陂镇龙苑工业区	4,741.48	自建	厂房	是
11	惠州威尔高	粤房地证字第 C6985427 号	博罗县麻陂镇龙苑工业区	3,523.02	自建	宿舍楼	是
12	惠州威尔高	粤房地证字第 C6985443 号	博罗县麻陂镇龙苑工业区	177.32	自建	工业仓储	是

13	惠州威尔高	粤房地证字第 C6985444 号	博罗县麻陂镇龙苑工业区	197.84	自建	工业仓储	是
14	泰国威尔高	43771	泰国大城府洛加纳大城工业区	47,530.00	自建	厂房	是
15	泰国威尔高			7,966.00	自建	废水处理站	是
16	泰国威尔高			3,918.00	自建	仓库	是
17	泰国威尔高			1,075.00	自建	门卫室及停车场	是
18	泰国威尔高	44115	泰国大城府洛加纳大城工业区	6,534.00	自建	宿舍	否
19	泰国威尔高			101.00	自建	水泵房、门卫室及停车场	否

4、专利情况

截至报告期末，公司拥有专利权 165 项，其中 65 项为发明专利、100 项为实用新型专利。

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式	他项权利
1	发行人	一种 PCB 分板机用具有自动定位装置的板料提升装置	发明专利	ZL201710118043.3	2017.03.01	继受取得	无
2	发行人	一种线路板喷涂烘干一体装置	实用新型	ZL201821486717.1	2018.09.11	原始取得	无
3	发行人	一种全自动的线路板开料装置	实用新型	ZL201821486679.X	2018.09.11	原始取得	无
4	发行人	一种有声孔的 PCB 线路板焊线用吸板	实用新型	ZL201921300704.5	2019.08.12	原始取得	无
5	发行人	一种 PCB 线路板手工对位防偏装置	实用新型	ZL201921300701.1	2019.08.12	原始取得	无
6	发行人	一种 PCB 成型除尘装置	实用新型	ZL201921300209.4	2019.08.12	原始取得	无
7	发行人	一种 PCB 线路板防护装置	实用新型	ZL201921300189.0	2019.08.12	原始取得	无
8	发行人	PCB 用防焊塞孔万用导气板	实用新型	ZL201921300196.0	2019.08.12	原始取得	无
9	发行人	一种 PCB 线路板保护盒	实用新型	ZL201921300174.4	2019.08.12	原始取得	无
10	发行人	一种 PCB 板检测台	实用新型	ZL201921300177.8	2019.08.12	原始取得	无
11	发行人	一种 PCB 线路板自动清洁机构	实用新型	ZL201921300707.9	2019.08.12	原始取得	无
12	发行人	一种柔性 PCB 板的自动冲孔机	实用新型	ZL201921300706.4	2019.08.12	原始取得	无
13	发行人	上销钉机固定装置	实用新型	ZL201921300212.6	2019.08.12	原始取得	无
14	发行人	薄膜褶皱 PCB 制作整机	发明专利	ZL201811048455.5	2018.09.10	继受取得	无
15	发行人	一种系统集成电路板的散热装置	发明专利	ZL201910792332.0	2019.08.26	继受取得	无
16	发行人	一种电路板压平装置	发明专利	ZL201811163473.8	2018.09.30	继受取得	无
17	发行人	一种 PCB 板尺寸检测装置	实用新型	ZL202022567678.1	2020.11.09	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式	他项权利
18	发行人	一种 PCB 板的印刷装置	实用新型	ZL202022572618.9	2020.11.10	原始取得	无
19	发行人	一种 PCB 板 UV 固化设备	实用新型	ZL202022569294.3	2020.11.09	原始取得	无
20	发行人	一种 PCB 板电镀线震动装置	实用新型	ZL202022575230.4	2020.11.10	原始取得	无
21	发行人	一种 PCB 板防焊塞孔装置	实用新型	ZL202022601875.0	2020.11.12	原始取得	无
22	发行人	一种 PCB 板宽度限位装置	实用新型	ZL202022602423.4	2020.11.12	原始取得	无
23	发行人	一种 PCB 板连接固定装置	实用新型	ZL202022608942.1	2020.11.12	原始取得	无
24	发行人	一种 PCB 板信息采集设备	实用新型	ZL202022607823.4	2020.11.20	原始取得	无
25	发行人	一种 PCB 板自动翻转检测设备	实用新型	ZL202022620040.X	2020.11.13	原始取得	无
26	发行人	一种 PCB 板自动清洗设备	实用新型	ZL202022622674.9	2020.11.13	原始取得	无
27	发行人	一种全自动 PCB 板加工设备	实用新型	ZL202022623314.0	2020.11.13	原始取得	无
28	发行人	一种新型 PCB 板清洁装置	实用新型	ZL202022627566.0	2020.11.13	原始取得	无
29	发行人	一种 PCB 电子线路板智能钻孔设备用定位装置	实用新型	ZL202120764324.8	2021.04.15	原始取得	无
30	发行人	一种 PCB 电子线路板智能钻孔用除尘装置	实用新型	ZL202120765863.3	2021.04.15	原始取得	无
31	发行人	一种 PCB 电子线路板智能钻孔用固定装置	实用新型	ZL202120768008.8	2021.04.15	原始取得	无
32	发行人	一种方便卸料的 PCB 电子线路板钻孔装置	实用新型	ZL202120770310.7	2021.04.15	原始取得	无
33	发行人	一种具有自动定位功能的 PCB 电子线路板钻孔设备	实用新型	ZL202120762330.X	2021.04.15	原始取得	无
34	发行人	一种线路板生产用防氯气泄漏吸收装置	实用新型	ZL202121151283.1	2021.05.27	原始取得	无
35	发行人	一种 PCB 板生产用自动包装设备	发明专利	ZL202011178110.9	2020.10.29	原始取得	无
36	发行人	一种新能源汽车用线路板清洗设备	发明专利	ZL202110402086.0	2021.04.14	原始取得	无
37	发行人	一种 PTFE 高频线路板加工用定位机构	实用新型	ZL202120576809.4	2021.03.22	原始取得	无
38	发行人	一种用于动力电池的线路板	实用新型	ZL202120576792.2	2021.03.22	原始取得	无
39	发行人	一种充电枪线路板加工用磨边装置	实用新型	ZL202120576806.0	2021.03.22	原始取得	无
40	发行人	一种用于线路板生产次氯酸杀毒液制取装置	实用新型	ZL202121151266.8	2021.05.27	原始取得	无
41	发行人	一种通讯用高频多层印制线路板	实用新型	ZL202120578050.3	2021.03.22	原始取得	无
42	发行人	一种信号通讯用 PTFE 高频线路板	实用新型	ZL202120578109.9	2021.03.22	原始取得	无
43	发行人	一种通信 PCB 线路板生产用冲孔装置	实用新型	ZL202120578087.6	2021.03.22	原始取得	无
44	发行人	一种新能源汽车电池控制线路板测试装置	实用新型	ZL202120578069.8	2021.03.22	原始取得	无
45	发行人	一种通讯用高频多层印制线路压合装置	实用新型	ZL202120578111.6	2021.03.22	原始取得	无
46	发行人	一种变频器 PCB 板安装用	实用新型	ZL202122456811.0	2021.10.13	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式	他项权利
		冲孔装置					
47	发行人	一种 PCB 板生产加工钻孔清理装置	实用新型	ZL202122454152.7	2021.10.12	原始取得	无
48	发行人	一种显示屏 PCB 板高效铺胶装置	实用新型	ZL202122470782.3	2021.10.14	原始取得	无
49	发行人	一种 Se 变频器 PCB 板输送装置	实用新型	ZL202122456825.2	2021.10.13	原始取得	无
50	发行人	一种 Se 变频器 PCB 板表面防焊油墨喷涂装置	实用新型	ZL202122456879.9	2021.10.13	原始取得	无
51	发行人	一种 MiniLED 显示屏 PCB 板回收处理装置	实用新型	ZL202122454146.1	2021.10.12	原始取得	无
52	发行人	一种 PCB 板生产用镀铜装置	实用新型	ZL202122454160.1	2021.10.12	原始取得	无
53	发行人	一种复合式新能源汽车用线路板压紧固定装置	实用新型	ZL202120576779.7	2021.03.22	原始取得	无
54	发行人	一种新能源汽车充电车载 OBC 线路板检测治具	实用新型	ZL202120578081.9	2021.03.22	原始取得	无
55	发行人	一种 LED 生产用 PCB 板高效除尘装置	发明专利	ZL202011390568.0	2020.12.02	原始取得	无
56	发行人	一种 PCB 板生产用表面粘尘设备	发明专利	ZL202110546929.4	2021.05.19	原始取得	无
57	发行人	一种工业互联网机械臂用线路板包装设备	发明专利	ZL202110425372.9	2021.04.20	原始取得	无
58	发行人	一种用于新能源汽车线路板原材切割设备	发明专利	ZL202110340088.1	2021.03.30	原始取得	无
59	发行人	一种工业智能互联网线路板检查维修用稳固设备	发明专利	ZL202110339413.2	2021.03.30	原始取得	无
60	发行人	一种 pp 芯板压合装置	实用新型	ZL202220179366.X	2022.01.24	原始取得	无
61	发行人	一种线路板辅助固定夹	实用新型	ZL202220201399.X	2022.01.25	原始取得	无
62	发行人	一种 PCB 板蚀刻用保护膜贴膜装置	实用新型	ZL202220130456.X	2022.01.19	原始取得	无
63	发行人	一种线路板丝印铝片揭取装置	实用新型	ZL202220210504.6	2022.06.17	原始取得	无
64	发行人	一种用于 PCB 固定底板制造机器	发明专利	ZL202110546181.8	2021.05.19	原始取得	无
65	发行人	一种 LED 生产用 PCB 板表面清理机器	发明专利	ZL202110513324.5	2021.05.11	原始取得	无
66	发行人	一种针对 PCB 板固定座用的通孔成型设备	发明专利	ZL202011402353.6	2020.12.04	原始取得	无
67	发行人	一种 PCB 防止表面氧化设备	发明专利	ZL202011396521.5	2020.12.03	原始取得	无
68	发行人	一种基于新能源汽车的动力电池线路板生产时的热风吹干装置	发明专利	ZL202110312835.0	2021.03.24	原始取得	无
69	发行人	一种 PCB 线路板辅助压合装置	实用新型	ZL202220146242.1	2022.01.20	原始取得	无
70	发行人	一种 PCB 板检验后打包出厂设备	发明专利	ZL202110538399.9	2021.05.18	原始取得	无
71	发行人	一种 PCB 板焊锡用辅助夹紧装置	实用新型	ZL202220125131.2	2022.01.18	原始取得	无
72	发行人	一种 PCB 板生产用多工位定位开孔设备	发明专利	ZL202110511809.0	2021.05.11	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式	他项权利
73	发行人	一种多层通信 PCB 线路板生产用制造装置	发明专利	ZL202210236079.2	2022.03.11	原始取得	无
74	发行人	一种新能源汽车用嵌入式智能线路板	发明专利	ZL202110447146.0	2021.04.25	原始取得	无
75	发行人	一种用于线路板生产的退锡提取装置	发明专利	ZL202110590914.8	2021.05.28	原始取得	无
76	发行人	一种新能源汽车用可用于照明的节能智能线路板	发明专利	ZL202110447843.6	2021.04.25	原始取得	无
77	发行人	一种印刷电路板曝光台面异物处理装置	实用新型	ZL202220258790.3	2022.02.09	原始取得	无
78	发行人	一种印刷线路板磨边装置	实用新型	ZL202220266907.2	2022.02.10	原始取得	无
79	发行人	一种线路板填孔电镀装置	实用新型	ZL202220254222.6	2022.02.08	原始取得	无
80	发行人	一种 LED 生产 PCB 固定底板冲孔设备	发明专利	ZL202110537987.0	2021.05.18	原始取得	无
81	发行人	一种 FBC 线路板的静态弯折力检测装置	发明专利	ZL202210208433.0	2022.03.04	原始取得	无
82	发行人	一种通讯用双面线路板	发明专利	ZL202111644820.0	2021.12.30	原始取得	无
83	发行人	一种耐腐蚀电源线路板	发明专利	ZL202111654774.2	2021.12.31	原始取得	无
84	发行人	一种具备散热结构的厚铜电源线路板	发明专利	ZL202111633362.0	2021.12.29	原始取得	无
85	发行人	一种线路板抗压性检测台	发明专利	ZL202210269703.9	2022.03.18	原始取得	无
86	发行人	金手指的斜边加工系统及其方法	发明专利	ZL202311133549.3	2023.09.05	原始取得	无
87	发行人	基于调节蚀刻方向结构的线路板内层异形线路蚀刻工艺	发明专利	ZL202511160550.4	2025.08.19	原始取得	无
88	发行人	超厚 5G 天线模块的制作系统及其方法	发明专利	ZL202311094803.3	2023.08.29	原始取得	无
89	发行人	一种线路板生产过程中溶液含锡量检测装置	发明专利	ZL202110590204.5	2021.05.28	原始取得	无
90	惠州威尔高	一种蓝胶印制装置	实用新型	ZL201920939271.1	2019.06.21	原始取得	无
91	惠州威尔高	一种自动识别的测试机	实用新型	ZL201821371962.8	2018.08.24	原始取得	无
92	惠州威尔高	一种印刷电路板阻焊层的剥离剂及其制备方法	发明专利	ZL201710786769.4	2017.09.04	原始取得	质押
93	惠州威尔高	一种用于印制电路板的干膜显影液及其制备方法	发明专利	ZL201710786750.X	2017.09.04	原始取得	无
94	惠州威尔高	一种自动化油墨粘涂设备	实用新型	ZL201920236169.5	2019.02.25	原始取得	无
95	惠州威尔高	一种排版菲林悬挂装置	实用新型	ZL201821372589.8	2018.08.24	原始取得	无
96	惠州威尔高	一种线路板外观检查机	实用新型	ZL201821373205.4	2018.08.24	原始取得	无
97	惠州威尔高	一种自动图案打印机	实用新型	ZL201821382214.X	2018.08.24	原始取得	无
98	惠州威尔高	一种油压机用真空泵水循环过滤装置	实用新型	ZL201920939247.8	2019.06.21	原始取得	无
99	惠州威尔高	一种电镀退镀缸	实用新型	ZL201920939079.2	2019.06.21	原始取得	无
100	惠州威尔高	一种 PCB 高氨氮废水脱氮系统	实用新型	ZL201920939076.9	2019.06.21	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式	他项权利
101	惠州威尔高	一种空压机余热利用装置	实用新型	ZL201920939072.0	2019.06.21	原始取得	无
102	惠州威尔高	一种生产 PCB 退锡水废液回用系统	实用新型	ZL201920947673.6	2019.06.21	原始取得	无
103	惠州威尔高	一种激光光绘机用滚筒装置	实用新型	ZL202020703143.X	2020.04.30	原始取得	无
104	惠州威尔高	一种空压机节能系统	实用新型	ZL202020703277.1	2020.04.30	原始取得	无
105	惠州威尔高	一种污泥干化机	实用新型	ZL202020815337.9	2020.05.16	原始取得	无
106	惠州威尔高	一种蚀刻液循环再生的自动添加装置	实用新型	ZL202020815327.5	2020.05.16	原始取得	无
107	惠州威尔高	一种干膜渣减重机	实用新型	ZL202020701760.6	2020.04.30	原始取得	无
108	惠州威尔高	一种显影机用废水回收装置	实用新型	ZL202020704989.5	2020.04.30	原始取得	无
109	惠州威尔高	一种电路板退镀系统	实用新型	ZL202022777760.7	2020.11.26	原始取得	质押
110	惠州威尔高	一种 PCB 板运输装置	实用新型	ZL202022791296.7	2020.11.26	原始取得	质押
111	惠州威尔高	一种 PCB 板吹孔验孔装置	实用新型	ZL202022777771.5	2020.11.26	原始取得	质押
112	惠州威尔高	一种烤箱节能器	实用新型	ZL202022791275.5	2020.11.26	原始取得	无
113	惠州威尔高	一种 PCB 板自动切割装置	实用新型	ZL202022791289.7	2020.11.26	原始取得	无
114	惠州威尔高	一种基于图像对比的 PCB 板 U 型槽加工异常检测方法	发明专利	ZL202210465522.3	2022.04.29	原始取得	无
115	惠州威尔高	基于计算机视觉的 PCB 钻孔偏移检测方法	发明专利	ZL202210455095.0	2022.04.28	原始取得	无
116	惠州威尔高	PCB 成型槽漏锣快速检测方法、电子设备及存储介质	发明专利	ZL202210447460.3	2022.04.27	原始取得	无
117	惠州威尔高	一种精细线路碱性蚀刻方法	发明专利	ZL202210447491.9	2022.04.27	原始取得	无
118	惠州威尔高	一种用于线路板的吸水干燥装置	实用新型	ZL202220273394.8	2022.02.10	原始取得	无
119	惠州威尔高	一种 PCB 板显影装置	实用新型	ZL202220451394.2	2022.03.02	原始取得	无
120	惠州威尔高	一种用于扫描 PCB 板的 AIO 装置	实用新型	ZL202220466301.3	2022.03.04	原始取得	无
121	惠州威尔高	一种金手指引线的蚀刻方法及具有金手指的 PCB	发明专利	ZL202210407434.8	2022.04.19	原始取得	无
122	惠州威尔高	PCB 多层板钻孔效率提升方法以及电子设备	发明专利	ZL202210411960.1	2022.04.19	原始取得	无
123	惠州威尔高	一种 MINILED 薄板全自动连线的生产质量检测方法	发明专利	ZL202210649474.3	2022.06.10	原始取得	无
124	惠州威尔高	一种线路板烘干装置	实用新型	ZL202220127976.5	2022.01.08	原始取得	无
125	惠州威尔高	一种 MiniLED 薄板的焊接缺陷检测方法	发明专利	ZL202210659049.2	2022.06.13	原始取得	无
126	惠州威尔高	一种 PCB 板涂布设备	实用新型	ZL202220374368.4	2022.02.23	原始取得	无
127	惠州威尔高	基于 PCB 的 U 型槽加工方法、电子设备及存储介质	发明专利	ZL202210406001.0	2022.04.18	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式	他项权利
128	惠州威尔高	一种 PCB 板表面缺陷检测方法	发明专利	ZL202210854644.1	2022.07.20	原始取得	无
129	惠州威尔高	一种线路板蚀刻设备	实用新型	ZL202220140729.9	2022.01.19	原始取得	无
130	惠州威尔高	一种 MiniLED 线路板缺陷检测系统及检测方法	发明专利	ZL202211366294.0	2022.11.03	原始取得	无
131	惠州威尔高	基于显著性检测的电源控制电路板瑕疵检测方法及系统	发明专利	ZL202211477177.1	2022.11.23	原始取得	无
132	惠州威尔高	基于图像分析的金手指电路板检测方法	发明专利	ZL202211603756.6	2022.12.14	原始取得	无
133	惠州威尔高	基于全景图像的厚铜 PCB 板检测方法	发明专利	ZL202211477198.3	2022.11.23	原始取得	无
134	惠州威尔高	用于 MiniLED 晶圆缺陷的快速检测系统	发明专利	ZL202211603748.1	2022.12.14	原始取得	无
135	惠州威尔高	一种 MiniLED 薄板生产过程的质量检测方法	发明专利	ZL202310044068.9	2023.01.29	原始取得	无
136	惠州威尔高	一种厚铜 PCB 板及加工方法	发明专利	ZL202310044060.2	2023.01.29	原始取得	无
137	惠州威尔高	基于数字图像分析的金手指电路板缺陷快速检测系统	发明专利	ZL202310101083.2	2023.02.13	原始取得	无
138	惠州威尔高	电脑显示板层压工序蚀刻质量检测方法	发明专利	ZL202310301494.6	2023.03.27	原始取得	无
139	惠州威尔高	一种电路板生产的防偏移压合设备和压合方法	发明专利	ZL202410240690.1	2024.03.04	原始取得	无
140	惠州威尔高	一种高频印刷电路板的显影质量检测方法	发明专利	ZL202410269280.X	2024.03.11	原始取得	无
141	惠州威尔高	一种用于电路板印刷的曝光优化方法	发明专利	ZL202410269507.0	2024.03.11	原始取得	无
142	惠州威尔高	一种阻焊显影线生产系统	实用新型	ZL202323186607.7	2023.11.24	原始取得	无
143	惠州威尔高	一种电镀槽液搅拌过滤设备	实用新型	ZL202323400250.8	2023.12.13	原始取得	无
144	惠州威尔高	一种已段烤板储存箱	实用新型	ZL202323664214.2	2023.12.29	原始取得	无
145	惠州威尔高	一种碱性蚀刻药水添加装置	实用新型	ZL202420333053.4	2024.02.22	原始取得	无
146	惠州威尔高	一种线路板微孔镀铜装置	实用新型	ZL202422087449.8	2024.08.27	原始取得	无
147	惠州威尔高	一种高精密多层显示板线路导通性测试系统及方法	发明专利	ZL202510422226.9	2025.04.07	原始取得	无
148	惠州威尔高	基于防偏定位的厚铜电源板压合控制方法及系统	发明专利	ZL202510442997.4	2025.04.10	原始取得	无
149	惠州威尔高	适用于线路板的钻孔控制方法、系统及设备	发明专利	ZL202510565016.5	2025.04.30	原始取得	无
150	惠州威尔高	一种油墨丝印装置	实用新型	ZL202421963666.2	2024.08.13	原始取得	无
151	惠州威尔高	一种金手指引线缺口检测装置	实用新型	ZL202422143744.0	2024.09.02	原始取得	无
152	惠州威尔高	一种基于精确定位的电路板油墨丝印方法及定位装置	发明专利	ZL202510630206.0	2025.05.16	原始取得	无
153	惠州威尔高	基于数据分析的 PCB 板热压均匀度分析方法	发明专利	ZL202510500132.9	2025.04.21	原始取得	无
154	惠州威尔高	用于印刷线路板药水槽清洗后的药水浓度检测方法	发明专利	ZL202510535462.1	2025.04.27	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式	他项权利
155	惠州威尔高	基于图像识别的线路板微孔镀铜品质检验方法	发明专利	ZL202510652683.7	2025.05.21	原始取得	无
156	惠州威尔高	一种短孔短槽定位纠偏钻孔装置	实用新型	ZL202420502213.3	2024.03.14	原始取得	无
157	惠州威尔高	一种钢板离型剂涂覆装置	实用新型	ZL202323290894.6	2023.12.04	原始取得	无
158	惠州威尔高	一种线路板显影装置	实用新型	ZL202420163874.8	2024.01.23	原始取得	无
159	惠州威尔高	一种电镀用夹具	实用新型	ZL202420353012.1	2024.02.26	原始取得	无
160	惠州威尔高	一种 PCB 板钻锣装置	实用新型	ZL202421534218.0	2024.07.01	原始取得	无
161	惠州威尔高	一种风机结构	实用新型	ZL202421615079.4	2024.07.09	原始取得	无
162	惠州威尔高	一种 PCB 板热压装置	实用新型	ZL202421838221.1	2024.07.31	原始取得	无
163	惠州威尔高	一种 PCB 板生产用的清洗装置	实用新型	ZL202422260763.1	2024.09.14	原始取得	无
164	惠州威尔高	一种电路板金手指引线缺口的视觉检测方法及系统	发明专利	ZL202511373821.4	2025.09.25	原始取得	无
165	惠州威尔高	一种 PCB 线路板自动化贴膜装置及其贴膜控制方法	发明专利	ZL202511460602.X	2025.10.14	原始取得	无

（七）业务经营资质

截至本募集说明书签署日，根据企业信用报告（无违法违规证明版）、境外律师出具的《境外法律意见书》、企业出具的说明及经保荐机构核查，发行人及其子公司已经取得与其生产及经营相关的必要资质，报告期内其生产及经营符合其注册地和经营地的法律和监管要求，不存在重大违法违规行为。其业务范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（八）核心技术来源

公司主要产品的核心技术及其来源如下：

序号	核心技术名称	技术来源	技术先进性及其特征
1	内层超厚铜电路板技术	自主研发	采用高精度激光钻孔+阶梯式电镀技术，通过优化铜层沉积速率与电流密度分布，实现内层铜厚突破 50μm。
2	阻焊气泡优化技术	自主研发	通过 AI 视觉检测+微环境温湿度智能调控，结合阻焊油墨流变特性建模，实现气泡生成全周期监控与动态补偿。
3	钻锣一体工艺技术	自主研发	通过定制化复合设备集成钻孔与锣板功能，基于动态换刀系统实现工序无缝衔接，采用多轴联动控制技术确保加工路径精度。
4	PCB 板热压工艺技术	自主研发	基于热压扩散焊技术，通过精准控制温度（±1℃）、压力（±0.1MPa）及时间参数，实现多层 PCB 材料间分子级结合。
5	平面变压器印制电路板制作技术	自主研发	采用多层互联集成技术，将变压器功能与 PCB 基板一体化设计，核心原理为平面螺旋绕组与磁性材料的三维集成。
6	埋铜块压合技术	自主研发	通过激光钻孔-铜块埋入-高温高压压合一体化工艺，实现铜块与多层板的无缝结合，利用激光微导孔精准定位埋入铜块，经高温高压消除界面空隙。

7	高层次厚铜板树脂塞孔技术	自主研发	通过树脂微胶囊填充与纳米级界面改性技术，实现孔径 50-200μm、板厚 1.6-6.0mm 厚铜板的高精度树脂填充。
8	36 层 AI 高算力可靠防焊工艺技术	自主研发	基于 AI 算法动态优化防焊参数，采用纳米级阻焊油墨定向涂覆技术，实现 36 层板层间防焊一致性控制，抗焊性＞200℃/2h 无起泡，耐电压＞5kV/mm，层间对准精度±2μm，生产良率提升至 99.2%。
9	厚铜电源板防层偏压合工艺研究	自主研发	通过优化防层偏压合压力梯度（±5%精度）与温度场分布（±2℃均匀性），采用双固化树脂体系实现铜层与介质层界面应力补偿，抑制厚铜区（≥100μm）分层风险。
10	利用 AI 过滤功能提升检验效率的方法研究	自主研发	基于深度学习卷积神经网络（CNN）构建 AI 视觉质检模型，通过 5G 传输高清 PCB 图像至高算力 AI 服务器，实时完成缺陷分类与定位。
11	镀铜柱技术	自主研发	采用图形电镀正片工艺实现高密度铜柱成型，核心解决高散热与细间距线路协同制造难题。
12	电源模块超高精度尺寸公差±0.025mm 技术	自主研发	采用 AI 视觉定位与精密伺服控制系统，通过 CCD 成型走刀路径动态优化算法实现尺寸闭环控制。
13	电源模块产品防焊薄油墨厚度控制技术	自主研发	通过优化阻焊油墨填充机制与印刷参数，实现高面铜密度下的精准厚度控制。
14	通盲孔对位技术	自主研发	基于多层板压合工艺建立涨缩补偿模型，通过逆向工程计算首次压合芯板预涨缩值，实现机械盲孔与内层图形精准对位。
15	超高层厚铜加工技术	自主研发	通过内层铺铜网格化设计（线宽/间距≤0.1mm）、分段钻孔（0.15mm-1.0mm 孔径适配）及涂层钻咀（TiAlN 镀层）提升钻孔精度，结合化学+等离子除胶（残胶率＜0.5%）实现高密度互联。
16	三次电源产品埋磁芯技术	自主研发	采用 8L 4 压 4 阶 HDI 结构，板厚 3.8±0.15mm，核心工艺通过 L4-5 层假四层设计实现电感位置电镀填平，L1-2/L2-3/L3-4 及 L8-7/L7-6/L6-5 采用 4mil 盲孔设计，L4-5 层埋孔结合 POFV 工艺实现 8mil 孔径精准控制，电感厚度 3.0±0.05mm，平整度≤100μm。
17	电源模块产品阴阳铜（2.5oz 与 6oz）技术	自主研发	采用差异化厚铜设计，内层 2oz（常规），表层 L1 层 2.5oz、L6 层 6oz，通过高精度内层压合、外层加厚铜箔激光钻孔及阶梯式电镀工艺实现阴阳铜结构。
18	厚铜板关键技术研发	自主研发	通过多次真空蚀刻提升线路蚀刻因子、优化叠构设计及压合程式改善压合缺胶、钻孔使用分段钻孔方式解决内层铜钉头、防焊线路印刷技术解决线路油墨偏薄，尤其是印刷后抽真空技术攻克行业内防焊后线路间残留气泡导致的可靠性潜在风险等；应用于蚀刻、压合、钻孔、防焊等工序。
19	Mini Led 线路关键技术研发	自主研发	通过采用溅射工艺在遮挡膜表面和镂空内沉积得到导电层，并去除遮挡膜和遮挡膜表面的导电层，留下镂空内的导电层形成线路层，线宽/线距最小可达到 38um，满足小间距 LED 显示屏中 Mini LED 技术的应用要求；应用于线路图形转移工序，线路更精密。
20	高 TG 印制线路板生产技术	自主研发	通过增加特殊流程，增强线路板耐热性，在吸湿后受热下，材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各性能较强；应用于压合工序，使得高 TG 产品具备高稳定性、高可靠性。
21	高精密抗氧化线路板生产技术	自主研发	通过提高显影的稳定性和抗氧化性，延长 PCB 的使用寿命，实现精准定位识别，提高产品精度；应用于线路蚀刻工序，产品具有高抗氧化、高精密、高散热性、稳定性高等特性。
22	高精密特制厚金线路板生产技术	自主研发	通过提高阻焊层油墨脱落速度而减少对 PCB 的腐蚀，稳定性较高的干膜显影液有效维持微细图案的显影性；应用于电金工序，在加厚工序中增加加热器，增快电解速度。
23	精细线路碱性蚀刻方法	自主研发	碱性蚀刻过程中通过抽风控制及调整子液浓度的配比，维持碱性蚀刻液 PH 值，保证再生反应的稳定性，达到提升精细线路的蚀刻因子；应用于线路蚀刻工序，线路更精密。
24	金手指引线的蚀刻方法	自主研发	镀金手指后二次压干膜，再通过曝光及显影，把金手指引线裸露，利用碱性蚀刻药水去除金手指引线；应用于金手指引线去除工序。
25	PCB 多层板钻孔效率提升方法	自主研发	通过优化提升 PCB 多层板钻孔效率，降低生产成本，降低钻孔偏孔风险；应用于钻孔工序，可提高钻孔稼动率到 97%以上。
26	PCB 涨缩板钻孔探究技术	自主研发	通过高多层涨缩板单元之间的钻带间距平移技术，保证钻孔后孔间距满足尺寸要求；应用于钻孔工序，有效改善涨缩导致的单元尺寸异常，同时确保无偏孔。
27	PCB 钻孔偏移检测方法	自主研发	根据钻孔区域图像中钻孔之间的距离构建无序数组，根据偏移程度确定可靠程度，偏移无序数组中所有距离计算中心钻孔的重要程度，根据影响程度确定 PCB 板的质量；应

			用于钻孔工序，实现钻孔偏移的精确检测。
28	半孔加工技术	自主研发	通过增加内定位、先退膜工艺制作金属化半孔 PCB，保证半孔质量的同时缩短制程时间，降低制程成本，提高生产效率。
29	PCB 背钻控深技术	自主研发	通过对毛刺披锋去除的研究，测试碱性蚀刻去除孔口披锋的效果，导出既能保证在控深钻过程中，保控深极差控制在±25μm，同时毛刺披锋减少。
30	新能源汽车用嵌入式智能线路板的技术	自主研发	减震机构对线路板的移动起到缓冲作用，延长使用寿命；散热机构提高散热的效果，使得冷却液能够循环使用，达到节能的效果。

五、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）公司发展战略

公司的发展战略目标为：面对国家高质量发展、建设现代化产业体系、加快高水平科技自立自强、深入推进数字中国建设的总体要求，借助“万物互联、AI 智能”时代发展趋势，充分利用在细分领域多年积累的丰富经验，结合自身竞争管理优势，制定了以“AI 数据中心电源、新一代通讯、新能源、汽车电子”为产品导向的发展战略，始终坚持深耕客户，技术立命的战略方针，通过技术革新、产能储备和智能化生产，创造各方多赢的可持续发展模式，建立客户、供应商、职员的共同幸福圈，致力于成为全球优秀的电子产品制造服务商。

面对 AI 算力爆发与数据中心供电架构快速升级的产业机遇，公司将以 DC-DC 为代表的高端电源 PCB 作为战略性倾斜与近年优先发展的核心方向。未来三年，公司将进入高质量发展的关键时期，重点把握 AI 电源需求的重要机遇，将战略规划落至实处，以业务国际化与产品高端化为两大核心发力方向。业务方面，公司积极推进海外布局，以泰国事业部作为海外桥头堡，致力于为更多海外头部客户提供最前沿一体化的高端产能，协同国内生产基地，构建起国内国际双循环的良好市场布局。产品方面，公司通过强研发、深拓展的具体实践行动，实现现有产品快速、稳定、高良率极致交付，增强在高多层、高频高速、HDI 等高端产品的量产能力，提高公司核心竞争力，实现高质量、跨越式发展。

（二）公司发展计划

围绕公司战略目标规划，提出高质量发展经营计划要求，即“构建新发展格局，形成国内+国际双循环定位布局”，满足差异化客户需求，重点推动产品结构升级，全面提高研发创新能力、工厂制程能力，推动工厂管理信息化、业务数字化、生产智能化、决策数据化发展。

1、高端产品研发计划

为了满足客户个性化、多样化的需求，公司将进一步深入对高多层板、高频高速板、HDI 特殊工艺板的研发，储备对位精度控制、多次压合尺寸稳定性控制、精细线路技术、Laser 微孔技术、盲孔电镀填孔技术、高速材料混压技术、高精度阻抗控制、互联可靠性等高端板技术能力，不断丰富产品结构。AI 电源高端产品方面，DC-DC 电源模块作为 AI 供电的关键环节，正成为最具备增长潜力的细分领域之一。公司将针对性开发 DC-DC 高端电源应用所需的超厚铜、嵌埋式等高端 PCB 工艺，围绕行业发展趋势，重点发展技术处于起步阶段、工艺复杂程度高、产品利润空间大的新兴产品，进一步增强技术领先优势，从而不断迭代公司的收入与利润增长点。

2、应对国际贸易影响，同步拓展和布局海外高端产品，优化产品结构

中国的印制电路板产值稳居全球第一，拥有良好的市场前景，然而 2025 年以来国际关系紧张叠加地区政治局势动荡，国内的电子信息产业因此受到较大冲击。2023 年，公司通过对泰国项目的投资，有效应对国际形势变化带来的贸易风险，显著增强了公司的经营韧性并推动发展进入快车道。近两年，以 AI 电源为代表的中高端应用领域需求快速增加，新投建的泰国中高端产能对这部分需求形成了良好的承接，并快速实现了预期效益。

3、加大市场开拓力度、提升销售服务能力

加强现有重点客户深入合作，进一步拓展国外高端市场。公司将充分发挥在技术、管理、质量等方面竞争优势，加强与现有重点客户之间的深度绑定与合作，尤其是提升与 AI 电源客户合作层次，争取更多高端产品订单，实现增加附加值的目标。与此同时，公司将加大国外高端市场开拓的力度，重点挖掘 AI 电源、电控、显示、汽车电子等高附加值下游应用领域的客户，加大销售资源投入。

4、强化品质稳定

印制电路板生产涉及的工序复杂、技术要求严格、对精度要求较高，为了提高良品率，降低生产成本，公司购置先进的自动化生产设备，建设先进、高效的自动化生产线，满足产品的自动化生产，深度应用制造信息化管理系统，

进一步细化生产信息化、数字化管理，品质追溯管理。通过引入新工艺、新设备，可以有效提高印制电路板的良品率，降低生产成本，全面提升生产运营效率，从而实现产值效率最大化，为公司创造更大的经济效益。

5、人才发展计划

优秀的技术管理人才是公司实现战略目标的重要基础，企业发展规模化、产品多样化、工艺高端化都离不开专业团队的稳固支撑，未来公司将在现有团队基础之上，着力于培养一支精干、高效的专业技术管理团队，进一步巩固公司的人力资源优势。在公司的发展战略和经营规划下，为了满足公司在不同发展时期对人员的需求，公司成立了威尔高知行学院，通过内外部培训，提升研发人员的创新开拓能力、生产型人员的技术水平和业务人员的业务拓展能力；同时通过多种渠道大力引进高学历人员、拥有大中型 PCB 企业管理经验的中高级管理人员、理论基础扎实且 PCB 专业技术过硬的研发人员、市场洞察力敏锐且懂行业及产品的营销人员等，建立一支能够适应企业快速发展、高效且具有较强执行力的骨干型人才队伍。

六、截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资

（一）财务性投资的认定标准

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

金额较大是指公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（二）最近一期末，公司不存在持有金额较大的财务性投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在最近一期末持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。公司资产负债表中可能涉及财务性投资的主要科目包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款、其他流动资产、长期股权投资、其他非流动资产，具体分析如下：

1、货币资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金情况如下：

单位：万元

项目	期末账面价值
库存现金	2.94
银行存款	27,969.93
其他货币资金	15,879.73
合计	**43,852.60**

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金及银行借款质押保证金，不属于财务性投资。

2、交易性金融资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司无交易性金融资产。

3、其他应收款

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	金额
应收补贴款（出口退税）	215.24
代扣代缴款项	203.52
押金及保证金	29.98
员工备用金等	13.24
小计	**461.98**
减：坏账准备	29.60
合计	**432.38**

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应收款主要为应收退税款、代扣代缴款项、押金及保证金及员工备用金等，均不属于财务性投资。

4、其他流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	期末账面价值
待抵扣增值税净额	6,328.26
预缴的企业所得税	423.95
押金	416.71
其他	89.06
合计	**7,257.99**

截至 2026 年 6 月 30 日，公司的其他流动资产主要为待抵扣增值税净额、预缴的企业所得税及押金，均不属于财务性投资。

5、长期股权投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司无长期股权投资。

6、其他非流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	期末账面价值
长期资产的预付款项	11,774.89
合计	**11,774.89**

截至 2026 年 6 月 30 日，公司的其他非流动资产为预付的设备款和工程款，不属于财务性投资。

综上所述，截至 2026 年 6 月 30 日，公司未持有财务性投资，公司不存在最近一期末持有金额较大的财务性投资的情形。

（三）自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资及类金融业务情况

2026 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过本次向特定对象发行股票的相关决议。自本次发行的董事会决议日前 6 个月至今，发

行人不存在新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务的情形，具体如下：

1、投资类金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具之日，公司不存在已实施或拟实施投资类金融业务。

2、非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具之日，公司不存在实施或拟实施的非金融企业投资金融业务。

3、与公司主营业务无关的股权投资

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具之日，公司不存在实施或拟实施的与公司主营业务无关的股权投资。

4、投资产业基金、并购基金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具之日，公司不存在新设立或投资产业基金、并购基金的情形。

5、拆借资金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具之日，公司不存在对外资金拆借的情形。

6、委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具之日，公司不存在将资金以委托贷款的形式借予他人的情形。

7、购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具之日，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。为提高资金使用效率，公司对货币资金进行了现金管理，利用部分闲置资金购买理财产品。公司购买的理财产品具有持有周期短、收益稳定、流动性强等特点，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

8、类金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具之日，公司不存在类金融业务。

9、拟实施的财务性投资

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具之日，公司不存在拟实施财务性投资的相关安排。

综上，自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施财务性投资及类金融业务的情形。

七、同业竞争情况

（一）发行人是否存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业从事相同、相似业务的情况

公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。公司控股股东为嘉润投资，实际控制人为邓艳群及陈星。

截至 2026 年 6 月 30 日，除公司外，控股股东、实际控制人无控制的其他企业。

（二）避免同业竞争的承诺

1、控股股东避免同业竞争的承诺

（1）截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的其他企业均未直接或间接开展对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，也未参与投资任何对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争的其他企业。

（2）自本承诺函签署之日起，本企业及本企业控制的其他企业均不会直接或间接开展对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，也不会参与投资任何对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争的其他企业。

（3）如因公司及其下属子公司拓展或变更经营范围引致本企业控制的其他企业对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，则本企业将促成本企业控制的其他企业以停止经营相竞争业务的方式，或将相竞争业务纳入公司

或其下属子公司的方式，或将该等相竞争业务/股权/权益转让予无关联第三方的方式，消除潜在同业竞争。

（4）如本企业及本企业控制的其他企业获得的商业机会对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，本企业将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司，以确保公司及其他股东利益不受损害。

（5）本企业作为公司控股股东期间，保证上述承诺事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本企业将向发行人承担相应的经济赔偿责任。

截至本募集说明书出具日，公司控股股东嘉润投资同业竞争承诺履行情况良好，未发生同业竞争行为。

2、实际控制人避免同业竞争的承诺

（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业均未直接或间接开展对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，也未参与投资任何对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争的其他企业。

（2）自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业均不会直接或间接开展对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，也不会参与投资任何对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争的其他企业。

（3）如因公司及其下属子公司拓展或变更经营范围引致本人控制的其他企业对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，则本人将促成本人控制的其他企业以停止经营相竞争业务的方式，或将相竞争业务纳入公司或其下属子公司的方式，或将该等相竞争业务/股权/权益转让予无关联第三方的方式，消除潜在同业竞争。

（4）如本人及本人控制的其他企业获得的商业机会对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司，以确保公司及其他股东利益不受损害。

（5）本人作为公司实际控制人期间，保证上述承诺事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向发行人承担相应的经济赔偿责任。

截至本募集说明书出具日，公司共同实际控制人邓艳群和陈星同业竞争承诺履行情况良好，未发生同业竞争行为。

八、未决诉讼、仲裁及行政处罚等相关情况

（一）发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚

1、重大诉讼、仲裁

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司不存在涉案金额超过 100 万元的未决诉讼、仲裁。

2、行政处罚

发行人及合并范围内子公司报告期内受到行政处罚的情况如下：

序号	受罚主体	处罚时间	处罚文号	处罚事由	处罚结果
1	泰国威尔高	2025-6-27	大城府工业局办公室 0606 号	未经许可扩建厂房	（1）对泰国威尔高罚款 10 万泰铢； （2）对泰国威尔高董事宋文明罚款 10 万泰铢
2	泰国威尔高	2025-9-9	大城府工业局办公室 0036（2）号	未经许可扩建厂房	（1）对泰国威尔高基础罚款 5 万泰铢，附加罚款 20.5 万泰铢； （2）对泰国威尔高董事宋文明罚款 25.5 万泰铢
3	泰国威尔高	2025-9-24	大城府工业局办公室 0034（2）号	未经许可扩建厂房	（1）对泰国威尔高基础罚款 7.50 万泰铢，附加罚款 38.50 万泰铢； （2）对泰国威尔高董事宋文明罚款 46 万泰铢

上述第一项行政处罚系泰国威尔高未经许可扩建厂房，后因泰国威尔高经办人员对当地相关法规要求缺乏了解、未及时整改，导致泰国威尔高于 2025 年 9 月 9 日和 2025 年 9 月 24 日再次受到行政处罚。

根据 TWLS COMPANY LIMITED 出具的法律意见书，上述三项罚款均已缴清，泰国威尔高已完成整改并取得工厂扩建相关批准，此后未再受到任何行政处罚。鉴于上述三项行政处罚均以行政程序作出且未涉及刑事定罪、罚款金额处于法定罚款幅度的中间或较低水平且已按期缴纳，因此上述三项行政处罚

不构成重大违法违规行为。除上述三项行政处罚外，报告期内泰国威尔高未受到其他行政处罚、制裁或执法措施。

泰国威尔高已通过缴纳全部罚款并及时办理扩建工厂相关审批手续对上述违法行为进行了整改；同时，公司组织相关人员加强对泰国相关法律法规的学习，确保境外生产经营合法合规。

综上所述，泰国威尔高所受到的上述行政处罚不构成重大违法违规行为。

除上述情形外，发行人及合并范围内子公司报告期内不存在受到其他行政处罚的情形。

（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的重大诉讼、仲裁或行政处罚

截至本募集说明书签署日，持有发行人 5%以上股份的主要股东及发行人实际控制人不存在尚未了结的或可以合理预见的对本次发行构成实质性障碍的重大诉讼、仲裁事项或受到行政处罚的情形。

（三）发行人董事、高级管理人员的重大诉讼、仲裁或行政处罚

截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可以合理预见的对本次发行构成实质性障碍的重大诉讼、仲裁事项或受到行政处罚的情形。

九、报告期内交易所对发行人年度报告的问询情况

2025 年 6 月 17 日，公司收到深交所下发的《关于对江西威尔高电子股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函[2025]第 481 号），公司会同中介机构就相关问题进行了逐项落实，并完成了年报问询函回复。

2026 年 7 月 3 日，公司收到深交所下发的《关于对江西威尔高电子股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函[2026]第 809 号），公司会同中介机构就相关问题进行了逐项落实，并完成了年报问询函回复。

除此之外，报告期内深交所不存在其他对公司年度报告进行问询的情形，不存在对年报多次问询事项的情形。

十、发行人最近一期是否存在业绩下滑的情形

（一）公司业绩下滑情况、原因及合理性分析

2026 年 1-6 月，公司主要经营情况与上年同期对比具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动额	变动比例
营业收入	97,944.62	71,489.40	26,455.22	37.01%
营业利润	4,430.84	5,161.41	-730.57	-14.15%
利润总额	4,436.61	5,111.62	-675.02	-13.21%
净利润	4,429.34	4,520.25	-90.91	-2.01%
归属于上市公司股东的净利润	4,429.34	4,520.25	-90.91	-2.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,259.99	4,436.76	-176.77	-3.98%

2026 年 1-6 月，发行人营业收入同比上涨，但净利润小幅下滑，主要系汇率波动导致汇兑损失较上年同期增加 2,194.31 万元等因素所致。

（二）与同行业可比公司对比情况

2026 年 1-6 月及 2025 年 1-6 月，公司与同行业可比公司的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、营业收入相较上年同期变动情况如下：

单位：万元

项目		2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动额	变动比例
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	中富电路	3,533.36	1,314.82	2,218.54	168.73%
	奥士康	7,871.23	18,377.94	-10,506.71	-57.17%
	满坤科技	3,763.45	5,680.87	-1,917.42	-33.75%
	科翔股份	-7,527.85	-7,240.40	-287.44	3.97%
	金禄电子	5,423.41	4,649.95	773.47	16.63%
	骏亚科技	-1,218.77	2,515.64	-3,734.41	-148.45%
	公司	4,259.99	4,436.76	-176.77	-3.98%
营业收入	中富电路	117,207.60	84,913.73	32,293.88	38.03%
	奥士康	298,654.11	256,454.63	42,199.48	16.45%
	满坤科技	94,238.36	75,979.04	18,259.32	24.03%
	科翔股份	212,869.38	180,582.66	32,286.72	17.88%
	金禄电子	133,987.46	93,392.75	40,594.71	43.47%

	骏亚科技	134,926.51	126,414.25	8,512.26	6.73%
	公司	97,944.62	71,489.40	26,455.22	37.01%

2026 年 1-6 月公司营业收入与同行业可比上市公司变动趋势一致，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与同行业可比上市公司奥士康、满坤科技、骏亚科技变动趋势一致，与其他同行业上市公司的差异主要系汇率波动导致汇兑损失较上年同期增加 2,194.31 万元等因素所致。

综上，公司的业绩变动情况与同行业上市公司不存在重大差异，具备合理性。

第三节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家产业政策为 PCB 产业的高质量发展奠定了良好的基础

2026 年 3 月，全国人大表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（以下简称《十五五规划》）。《十五五规划》将科技创新置于国家发展全局的核心位置，明确提出推进电子信息全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料。对于 PCB 行业下游应用领域，《十五五规划》提出加快新一代信息技术、新能源、航空航天、低空经济等战略性新兴产业发展，推动脑机接口、具身智能、第六代移动通信等未来产业成为新的经济增长点；《十五五规划》特别强调，要加快人工智能等数智技术创新应用，强化算力、算法、数据等要素高效供给，打造具有国际竞争力的新兴支柱产业。

PCB 作为“电子产品之母”，广泛应用于集成电路、新能源、航空航天、低空经济、人工智能、移动通信等战略性新兴产业和未来产业集群，提升 PCB 产业创新体系的整体效能，对于新质生产力产业落地具有关键支撑作用。

2、PCB 市场空间广阔，产业规模迅速增长

PCB 行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业。2024 年，全球 PCB 产值为 735.65 亿美元。2025 年，受益于 AI 算力建设及相关高速网络基础设施推动等，全球 PCB 产值达到 858.36 亿美元，同比增长 16.7%。

未来在低碳化、智能化等因素的驱动下，服务器、高速网络基础设施等 PCB 下游应用行业预期仍将蓬勃发展，下游应用行业的蓬勃发展将带动 PCB 需求的持续增长。根据 Prismark 预测，未来五年全球 PCB 市场将保持稳定增长的态势，预计 2025 年至 2030 年全球 PCB 产值的年复合增长率达 11.0%，至 2030 年预计全球 PCB 市场将达到 1,446.10 亿美元。

从区域市场看，中国大陆市场表现优于其他区域，中国大陆 PCB 产值占全球 PCB 总产值的比例已由 2000 年的 8.1%上升至 2025 年的 57.8%，成为全球

PCB 主要生产供应地。据 Prismark 预测，我国大陆地区将继续保持全球制造中心地位，未来五年中国大陆 PCB 行业仍将持续增长，预计 2025 年至 2030 年的复合增长率为 10.5%，2030 年中国大陆 PCB 产值将达到 817.64 亿美元。

3、AI 产业驱动下游算力基础设施快速扩容，服务器电源 PCB 细分市场迎来战略机遇

随着全球人工智能技术进入快速迭代与产业渗透期，智能算力需求呈爆发式增长，带动数据中心基础设施与 AI 服务器电源市场进入高速扩张通道。

AI 服务器单机功耗的持续攀升对电源系统提出了更高要求。目前，AI 服务器单机功率已跃升至 100kW 以上，未来随着 AI 芯片持续升级，AI 服务器机柜功率或往 MW 级别发展，较传统服务器有数量级增长；要求供电系统具备更高的转换效率、功率密度与稳定性，使得服务器电源从传统配套件变成 AI 数据中心电力瓶颈下的关键战略部件。

根据 Valuates Reports 的研究，2024 年全球 AI 服务器电源市场规模约为 28.46 亿美元，预计至 2031 年将增至 608.10 亿美元，2025 至 2031 年年复合增长率约为 45%。同期，全球人工智能数据中心（AIDC）电源市场规模在 2024 年约为 49 亿美元，预计 2024 至 2030 年复合增长率可达 32.2%，已成为 AI 算力链中增速最快的细分赛道之一。

AI 服务器电源 PCB 承担电流传输、信号传输和热管理等功能，AI 服务器和高功率电源对 PCB 铜厚、层数、散热、可靠性提出更高要求，带动服务器电源 PCB 细分市场迎来战略机遇。

4、东南亚布局成为行业趋势，产业链聚集效应逐渐形成

目前，在东南亚投资布局成为 PCB 行业的新发展趋势。全球排名前列的 PCB 厂商基本均在东南亚投资布局，以泰国、越南等为代表的东盟国家的 PCB 产业集群逐渐形成。

近年来，泰国承接了较多的电子信息行业企业的产能转移，产业集群快速发展，吸引了台达电子、施耐德、麦格米特和冠捷科技等各类元器件制造商，下游客户在东南亚的布局以及与威尔高的紧密合作，为本次募集资金投资项目的顺利实施奠定了坚实基础。

此外，当前国际贸易摩擦持续升级，各种贸易壁垒令国内企业产品出口压力增加，以技术标准、知识产权、关税为代表的贸易壁垒层出不穷，给产业链带来的潜在风险不容忽视。在此背景下，公司在东南亚投资建设新的生产基地，是增强供应链韧性，提升抗风险能力的战略性举措。

（二）本次发行的目的

1、加快 AI 服务器电源 PCB 高端产能布局，把握行业发展机遇

近年来，全球算力基础设施快速扩张，带动 AI 服务器电源需求快速增长，其中，AI 服务器电源 PCB 作为核心配套组件，需求增速突出。

相比于传统 PCB，电源 PCB 在散热、可靠性等方面有极高要求，技术难度高、工艺复杂、附加值高。公司通过多年技术积累，对层压结合力、对准度、BGA 平整度等核心难题，从材料配方、工艺参数优化、设备定制化改造等多个维度进行了持续攻关，有效提高了产品整体可靠性。

目前，公司已完成从 AC-DC 向 DC-DC 的研发转型，核心 30 层 AI 服务器电源产品顺利通过第三方实验室可靠性认证，CAF、TCT 测试时长均达 1000 小时，远超行业常规标准；新品能效转化率≥95%，较传统一次电源提升 5%—10%，核心性能实现突破。

公司拟通过本次募集资金投资加快相关高端产能投入，在扩大经营规模的同时快速推动产品技术升级，满足下游核心客户不断增长的需求，同时扩大公司在高端 PCB、AI 服务器电源 PCB 的市场份额，并持续优化公司现有产品结构，进一步补强高端产能与精细化管控能力，全面提升核心竞争力，抢抓下游市场需求机遇。

2、顺应行业发展趋势，推动产品供应链多元本地化，降低国际贸易摩擦风险

随着公司境外销售的不断增加，公司对境外市场的重视程度日益提高。但近年来，国际贸易摩擦持续升级，各种贸易壁垒令国内企业产品出口压力增加，给产业链带来的潜在风险不容忽视；同时，海外客户对供应链地缘风险分散的战略重视度显著提高，普遍通过优化供应链节点、分散产能布局等方式，对冲物流时效波动与单一产能中断风险，以强化供应链稳定性与安全性。

在此背景下，公司在泰国投资扩建生产基地，既能精准匹配海外客户供应链布局需求、进一步巩固客户合作粘性，又能增强应对宏观经济波动、产业政策调整及国际贸易格局变化的战略灵活性，通过生产基地的全球化分散布局优化供应链韧性，进而显著提升公司整体抗风险能力。

同时，随着国际产业转移的不断深化和本国政策的支持，东南亚越来越多地承接了来自中国、欧美、日韩地区的新能源汽车、电子、通信等制造业产业，并逐渐形成了相对完善的产业链。通过实施本次募投项目，公司能够实现海外供应链的属地化，就近服务泰国等东南亚国家及地区客户，发掘海外市场新的增长点，形成多元化的海外市场格局，分享东南亚地区经济增长带来的红利，提升公司在全球 PCB 市场中的竞争力。

3、符合公司战略发展目标，持续构建并发展“新质生产力”

通过多年技术积累，公司在厚铜板（电机、电控、电源、AC-DC、DC-DC 产品升级迭代）等产品的研发和工艺技术上有核心优势。AI 电源产品领域，DC-DC 产品上突破 30 层产品技术壁垒，通过对高散热材料的研究测试，特殊埋铜、埋阻、埋容工艺的导入，助力 DC-DC 高端电源模块实现批量生产。

在发展中，公司积累了多项生产工艺技术，以持续的科研投入进行技术、制程能力储备，突出了核心技术能力，同时凭借长期技术积累与高效的客户服务体系，在 AI 服务器电源等核心领域积淀了稳定优质的客户资源。

AI 服务器电源 PCB 业务是公司未来发展战略的重点方向，建设高端 AI 类 PCB 项目是公司实现中长期目标的重要举措。本次募集资金投资项目将有助于公司进一步构建并发展“新质生产力”，积极响应国家发展战略，继续坚持以科技创新为核心驱动力，并不断向更前沿的行业技术、更高的技术水平、更优的生产质量前进。

4、充实公司资金实力，提升可持续发展能力

公司所处行业为技术密集型和资金密集型行业，技术研发、生产运营均需大量资金投入。目前，公司正处于产品结构升级及转型的重要机遇期，为了抢占 AI 服务器电源 PCB 等新兴领域市场，同时筑牢技术优势、抢抓发展机遇，进一步加大在技术研发、人才储备、生产设备、市场开发等方面的投入，亟需

投入大量资金。

本次募集资金到位后，将有助于公司增强资本实力、优化资产负债结构、提升盈利水平，增强公司抗风险能力和核心竞争力，推动公司发展战略进一步落地。

二、发行对象与发行人的关系

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次最终发行对象由股东会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

截至本募集说明书出具日，公司尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）本次发行证券的价格或定价方式

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，定价基准日为发行期首日。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股或资本公积转增股本等事项，公司将按照深交所的相关规则对前述发行底价作相应

调整。调整公式如下：

派发现金股利：$P_1=P_0-D$

送股或转增股本：$P_1=P_0/（1+N）$

两项同时进行：$P_1=（P_0-D）/（1+N）$

其中：P_0 为调整前发行底价，P_1 为调整后发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。

本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，按照相关规定根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

若国家法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

（二）发行数量

本次向特定对象发行 A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，按本募集说明书出具之日的总股本计算即不得超过 56,569,225 股（含本数），最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册批复后，由公司董事会根据股东会授权，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行对象申购报价情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将根据深交所和中国证监会相关规定进行相应调整。

（三）限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行股票的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安

排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、募集资金数额及用途

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 130,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目	74,830.88	60,000.00
2	泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目	71,749.91	60,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	10,000.00	10,000.00
合计		**156,580.79**	**130,000.00**

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述拟投入募集资金总额，在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会及其授权人士可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的投入优先顺序和各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整各项目拟投入金额。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书出具日，公司尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人控股股东为嘉润投资，持有公司 50.49%股份。邓艳群和陈星构成一致行动关系，邓艳群和陈星通过嘉润投资控制发行人 50.49%的股份；邓艳群直接持有公司 6.46%的股份；陈星直接持有公司 2.97%

的股份；邓艳群和陈星共同控制公司 59.91%的股份，为公司共同实际控制人。

本次发行不超过 56,569,225 股（含本数），按此上限测算，本次发行完成后嘉润投资控制公司 38.84%的股份，实际控制人邓艳群和陈星共同控制公司 46.09%的股份，嘉润投资仍为公司的控股股东，邓艳群和陈星仍为公司共同实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行股票的发行方案于 2026 年 7 月 15 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，于 2026 年 8 月 7 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

本次向特定对象发行股票尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会予以同意注册。

八、本次证券发行满足“两符合”和不涉及“四重大”相关规定

（一）满足“两符合”的相关规定

1、本次发行符合国家产业政策

公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，主要产品包括双面板、多层板，下游主要应用于 AI 服务器电源、工业控制、汽车电子、显示、消费电子、数字通讯等领域。根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C398 电子元件及电子专用材料制造”之“C3982 电子电路制造”。

（1）募集资金投资项目不属于淘汰类、限制类产业

公司本次募投项目为江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目、泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目和补充流动资金及偿还银行贷款，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，“新型电子元器件制造：高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠

印刷电路板及封装载板、高密度高细线路（线宽/线距≤0.05mm）柔性电路板等”被列为“鼓励类”发展产业。本次募投项目不属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中产能过剩行业或限制类、淘汰类行业，未被纳入《市场准入负面清单（2025 年版）》禁止准入类或许可准入类事项名单，符合国家产业政策要求。

（2）募集资金投资项目不属于落后产能

本次募投项目不涉及《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7 号）、《关于印发<淘汰落后产能工作考核实施方案>的通知》（工信部联产业〔2011〕46 号）、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41 号）、《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30 号）、《2015 年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告 2016 年第 50 号）以及《关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2020〕901 号）中的落后产能。

公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后，募集资金净额将投资于高端 AI 类电路板和高多层电路板业务，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

2、本次发行符合板块定位（募集资金主要投向主业）

本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 130,000.00 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目、泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目和补充流动资金及偿还银行贷款。公司本次募集资金投向围绕公司 PCB 主业进行布局，旨在增加公司高端 AI 类和高多层电路板产能。项目建成达产后，将形成年产 144 万平方米高端 AI 类电路板和 120 万平方米高多层电路板产能。

本次募投项目围绕公司 PCB 主营业务展开，募集资金不存在投向非主营业务的情形。

（二）不涉及“四重大”的情形

截至募集说明书签署日，公司主营业务及本次发行募投项目不涉及情况特

殊、复杂敏感、审慎论证的事项；公司本次发行不存在重大无先例事项；不存在影响本次发行的重大舆情；不存在相关投诉举报、信访等重大违法违规线索，本次证券发行符合《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定。

综上所述，公司本次发行满足“两符合”的相关规定，不涉及“四重大”的相关情形，符合《注册管理办法》第三十条、《证券期货法律适用意见第 18 号》以及《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定。

九、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的依据及融资间隔相关情况

1、关于本次证券发行数量

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十。

截至 2026 年 6 月 30 日，上市公司的总股本为 188,564,086 股，本次股票发行数量不超过 56,569,225 股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30%，符合发行数量的要求。

2、关于融资间隔

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。

公司前次募集资金为 2023 年首次公开发行股票，前次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 1 日。公司本次向特定对象发行股票的董事会决议日为 2026 年 7 月 15 日，董事会决议日前十八个月不存在首发、增发、配股、向特定对象发行股票，因此，公司本次融资符合融资时间间隔的要求。

3、关于募集资金用于补充流动资金和偿还债务等非资本性支出

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金

和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。对于具有轻资产、高研发投入特点的企业，补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应当充分论证其合理性，且超过部分原则上应当用于主营业务相关的研发投入。

本次募集资金投资项目中涉及非资本性投资的项目构成如下所示：

单位：万元

序号	项目名称	非资本性投资项目	金额	拟以募集资金投入
1	江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目	铺底流动资金	2,537.44	-
2	泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目	铺底流动资金	2,228.08	-
3	补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	10,000.00	10,000.00
合计			**14,765.52**	**10,000.00**

公司拟使用本次发行募集资金 10,000.00 万元用于补充流动资金，占募集资金投资总额的比例为 7.69%，未超过本次募集资金总额的 30%，符合相关要求。

综上，本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定。

十、因实施募投项目而新增的折旧和摊销对发行人未来经营业绩的影响

公司本次募投项目的实施将会使公司固定资产规模增大，并将在达到预定可使用状态后计提折旧，未来将增加公司折旧费用，在一定程度上影响公司的利润水平。本次募投项目建成后，预计达产年新增固定资产折旧及无形资产摊销 10,964.42 万元。在项目顺利实施后预计效益能够较好地消化新增折旧摊销的影响，经测算募投项目经济效益良好。但由于影响募集资金投资项目效益实现的因素较多，若募投项目实施后，市场环境等发生重大不利变化或公司市场拓展不及预期，导致募投项目产生效益的时间晚于预期或实际效益低于预期水平，则新增固定资产及无形资产折旧摊销将对发行人未来的盈利情况产生不利的影响。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 130,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目	74,830.88	60,000.00
2	泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目	71,749.91	60,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	10,000.00	10,000.00
合计		**156,580.79**	**130,000.00**

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定予以置换。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述拟投入募集资金总额，在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会及其授权人士可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的投入优先顺序和各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整各项目拟投入金额。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目

1、项目概况

类别	内容
项目名称	江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目
实施主体	江西威尔高电子股份有限公司
总投资	74,830.88 万元
主要建设内容	建成达产后，将新增年产 144 万平方米高端 AI 类电路板产能
建设地点	江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号

2、项目实施的必要性

（1）顺应产业趋势，抓住 AI 服务器电源 PCB 市场机遇

随着全球人工智能技术进入快速迭代与产业渗透期，智能算力需求呈爆发式增长，带动数据中心基础设施与 AI 服务器电源市场进入高速扩张通道。

目前，AI 服务器单机功率已跃升至 100kW 以上，未来随着 AI 芯片持续升级，AI 服务器机柜功率或往 MW 级别发展，较传统服务器有数量级增长；要求供电系统具备更高的转换效率、功率密度与稳定性，使得服务器电源从传统配套件变成 AI 数据中心电力瓶颈下的关键战略部件。

根据 Valuates Reports 的研究，2024 年全球 AI 服务器电源市场规模约为 28.46 亿美元，预计至 2031 年将增至 608.10 亿美元，2025 至 2031 年年复合增长率约为 45%。同期，全球人工智能数据中心（AIDC）电源市场规模在 2024 年约为 49 亿美元，预计 2024 至 2030 年复合增长率可达 32.2%，已成为 AI 算力链中增速最快的细分赛道之一。

相比于传统 PCB，电源 PCB 在散热、可靠性等方面有极高要求，技术难度高、工艺复杂、附加值高。公司通过多年技术积累，对层压结合力、对准度、BGA 平整度等核心难题，从材料配方、工艺参数优化、设备定制化改造等多个维度进行了持续攻关，有效提高了产品整体可靠性。

公司拟通过本次募集资金投资加快相关高端产能投入，在扩大经营规模的同时快速推动产品技术升级，满足下游核心客户不断增长的需求，同时扩大公司在 AI 服务器电源 PCB 的市场份额，并持续优化公司现有产品结构，全面提升核心竞争力，抢抓下游市场需求机遇。

（2）突破产能瓶颈，满足市场需求

随着 AI 服务器、新能源汽车、工业控制等下游行业的推动发展，公司加大了对国内和国际市场的拓展力度，近年来公司订单数量和客户数量均不断上升。2023 年至 2025 年，公司营业收入分别为 82,269.05 万元、102,164.21 万元和 154,430.66 万元，年均复合增长率为 37.01%，呈持续快速增长趋势；同时公司产能利用率保持在较高水平，生产能力趋于饱和。目前，公司下游客户需求旺盛，在手订单充足，亟需扩大产能以满足客户快速增长的需求。

通过本项目的建设实施，公司将新增年产 144 万平方米高端 AI 类电路板产能，公司生产能力将实现大幅提高，可满足下游客户对交货数量、交货周期和交货质量的要求，对于公司在稳定现有优质客户的同时继续扩大市场占有率具有重要的意义。

（3）积极响应国家产业政策导向，助力公司高端化转型，提升市场竞争力

近年来，国家高度重视新一代信息技术产业发展，先后出台《电子信息制造业数字化转型实施方案》、《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》、《制造业数字化转型行动方案》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》等一系列政策，明确支持推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料。PCB 作为“电子产品之母”，是支撑电子信息设备发展的关键载体，其高端化发展直接关系到下游电子信息产业的核心竞争力。

公司始终紧跟国家产业政策导向，积极践行产业升级责任，进行高端 PCB 产品研发与生产。本项目主要聚焦 AI 服务器电源等产品，并通过引入智能制造与数字化管理系统，可实现关键制程的精准控制与闭环管理，显著增强生产过程的稳定性与可控性，从而提升公司的自动化与智能化生产水平。本项目的实施，符合国家 PCB 行业高端化、自主化的政策导向，并能显著提升公司高端产品的规模化生产能力和质量稳定性，提升公司的市场竞争力。

3、项目实施的可行性

（1）公司多年的技术储备，为本次募投项目提供坚实的技术保障

公司从设立至今一直从事 PCB 的研发、生产和销售，通过持续不断的研发创新，公司已拥有多项自主研发的核心技术，具备生产高端 PCB 产品的实力。

从研发体系与成果来看，公司已建立起成熟的创新机制，并获得了权威认可。公司是国家高新技术企业，获得了江西省省级企业技术中心、江西省高成长性科技型企业等认定，在高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。

公司在厚铜板（电机、电控、电源、AC-DC、DC-DC 产品升级迭代）、Mini LED 光电板、平面变压器板、光模块、汽车电子板、通讯电子板等产品的

研发和工艺技术上有核心优势。AI 电源产品领域，DC-DC 产品上突破 30 层产品技术壁垒，通过对高散热材料的研究测试，特殊埋铜、埋阻、埋容工艺的导入，助力 DC-DC 高端电源模块实现批量生产，在小尺寸 Mini LED 产品上实现细密灯珠线路的批量加工生产。在发展中，公司积累了多项生产工艺技术，以持续的科研投入进行技术、制程能力储备，突出了核心技术能力。

公司的核心技术在生产制造过程中予以充分验证，覆盖 PCB 生产制造的全流程，依托成熟的技术积淀与规模化生产经验，公司可快速实现募投项目产能释放、产品稳定交付，确保项目投产后能够顺利达成预期目标，为公司项目建设提供了坚实的技术保障。

（2）公司具备丰富的优质客户资源，为本项目的产能消化奠定基础

由于 PCB 系根据客户的需求提供的定制化产品，知名客户通常对 PCB 品质、寿命、高可靠性要求更为严苛，因此对供应商资质要求高、审核过程长、认证时间久，一旦达成合作，基于对技术要求、产品质量、采购成本等多方面综合考虑，一般会与供应商形成长期合作关系。不同的下游应用领域对 PCB 的技术要求不同，在特定领域获取品牌客户认可，证明公司在该领域公司的产品质量值得信赖、技术水平先进，形成独有的竞争优势。

近几年，随着 AI 驱动下产品迭代升级加速，公司依托多基地的技术研发与快速量产优势，与客户深度绑定，共同开发新产品、研究新材料。公司良好的产品性能和品质表现获得了客户的高度认同，与台达电子、施耐德、三星电子、冠捷科技、比亚迪、长城电源、欧陆通股份、富士康、麦格米特、新雷能等客户长期战略合作，并多次获得客户颁发的奖项，在行业内形成了良好的客户口碑。优质的品牌客户资源提高了公司的品牌形象，有利于持续获得稳定的业务订单，并能有更多新的业务合作机会和新的市场空间，为本次募集项目的产能消化奠定基础。

（3）充足的人才储备和完善的人力资源规划，为募投项目的实施提供了重要保障

公司自成立以来，一直将人才团队的建设与培养视为公司主要的发展目标之一。在人员储备方面，公司拥有一支专业知识扎实、自主研发创新能力强、

实战经验丰富的专业研发人才团队，核心技术人员均为印制电路板行业的资深专家，具有长期、丰富的生产及技术研究开发经验。公司已经形成了一套成熟的管理制度与研发制度，组建了一支多层次、专业性强、经验丰富的管理团队和研发团队。

在公司的发展战略和经营规划下，为了满足公司在不同发展时期对人员的需求，公司成立了威尔高知行学院，通过内外部培训，提升研发人员的创新开拓能力、生产型人员的技术水平和业务人员的业务拓展能力；同时通过多种渠道大力引进高学历人员、拥有大中型 PCB 企业管理经验的中高级管理人员、理论基础扎实且 PCB 专业技术过硬的研发人员、市场洞察力敏锐且懂行业及产品的营销人员等，建立一支能够适应企业快速发展、高效且具有较强执行力的骨干型人才队伍。

公司充足的人才储备和完善的人力资源规划，为募投项目的实施提供了重要保障。

4、项目投资概算

本项目总投资金额为 74,830.88 万元，本次拟使用募集资金投入 60,000.00 万元，项目投资结构如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	配套工程设施费用	22,096.63	29.53%
2	设备购置及安装费用	50,196.81	67.08%
3	铺底流动资金	2,537.44	3.39%
合计		**74,830.88**	**100.00%**

5、项目经济效益

经测算，本项目税后静态投资回收期为 7.43 年（含建设期），税后内部收益率为 12.37%。

6、效益预测的假设条件及主要计算过程

本项目实施完毕后，主要经济效益指标如下：

序号	经济技术指标	数据	备注

1	年销售收入（万元）	118,656.00	达产年度
2	年利润总额（万元）	8,968.60	达产年度
3	内部收益率（%）	12.37	税后
4	投资回收期（年）	7.43	税后，含建设期

（1）效益预测的假设条件

①国家现行法律、法规无重大变化，行业的政策及监管法规无重大变化；

②募投项目主要经营所在地及业务涉及地区的社会、经济环境无重大变化；

③行业未来形势及市场情况无重大变化；

④人力成本价格不存在重大变化；

⑤行业涉及的税收优惠政策将无重大变化；

⑥募投项目未来能够按预期及时达产；

⑦募投项目销售量按照生产量测算；

⑧无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（2）营业收入测算

本项目营业收入的测算以 2025 年公司分层产品市场价格为基础并结合目标客户产品现有价格情况保守估计未来市场价格，同时根据项目的投资进度和运行情况估算投产后产品销量，预估价格乘以销量为本项目营业收入。

（3）成本测算

本项目生产成本主要为直接材料费、直接人工成本和制造费用，直接材料费用参照同类产品成本数据估算确定，直接人工成本由定员人数及预计平均工资确定。制造费用由折旧费用、加工费、维修费、动力费等构成。

（4）期间费用测算

本项目期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用。根据公司 2025 年度销售费用、管理费用、研发费用占营业收入的比例来进行测算。

（5）税金测算

项目税金及附加的测算主要包含增值税、所得税、城市维护建设税、教育

费附加等，相关税负按照税收法律法规的有关规定测算。

7、项目涉及土地、备案、环评审批情况

本项目建设地点位于江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号，项目用地已由威尔高以出让方式取得。公司已取得编号为赣（2022）井开区不动产权第 0000021 号的不动产证书。

截至本募集说明书签署日，公司已完成环评手续并取得了井冈山经济技术开发区生态环境局出具的《关于江西威尔高电子股份有限公司年产 540 万平方米高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目环境影响报告表的批复》（井开区环字[2022]8 号）。公司已完成项目备案的相关工作，取得了《江西省企业投资项目备案凭证》（2608-360800-04-01-563740）。

8、项目实施安排

本项目采用边建设边投产的方式，项目建设期 2 年，建成后的第 2 年达产 100.00%，本项目建设进度具体情况如下：

阶段/时间（月）	T+1				T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
可行性研究	■							
初步规划、设计	■							
房屋建筑及装修	■	■	■	■	■			
设备采购及安装					■	■	■	
人员招聘及培训					■	■	■	
试运行及投产						■	■	■

在项目实施过程中，公司将根据行业发展及市场需求情况及时调整项目的具体实施进度和募集资金使用进度。

（二）泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目

1、项目概况

类别	内容
项目名称	泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目
实施主体	威泰电子有限公司
总投资	71,749.91 万元
主要建设内容	建成达产后，将新增年产 120 万平方米高多层电路板产能

建设地点	泰国大城府育泰县堪韩镇 5 村 1 号

2、项目实施的必要性

（1）全球化战略释放增长驱动，需进一步深化海外产能协同布局

随着业务规模的不断扩大，以及客户需求的升级，公司持续推进全球化战略。公司泰国生产基地于 2024 年 6 月开始投产，产能稳步释放；随着海外客户的不断拓展以及 AI 爆发带来的旺盛产品需求，泰国威尔高业务增长迅速，于 2025 年度实现营业收入 44,877.18 万元，净利润 2,310.01 万元；目前，泰国威尔高在手订单充足，预计未来仍将保持较大幅度增长。

全球化战略已成为公司业绩增长的重要驱动因素，也是公司实现跨越式发展的必要举措。未来，公司需要进一步深化全球化布局，以泰国生产基地稳定量产为契机，紧紧抓住 PCB 产业转移之市场机遇，不断向海外知名企业拓展市场，扩大东南亚、欧美市场的占有率。

通过本项目的建设，强化公司海外产能的布局，有助于增强公司海外产品供应能力，更快速、高效、灵活地响应海外客户的订单需求，在激烈的全球市场竞争中巩固并提升公司的核心竞争力。

（2）下游快速迭代创新，高端 PCB 产品需求对技术和装备升级提出要求

服务器电源是为 AI 服务器、GPU 集群和数据中心机柜提供稳定高效电能转换的核心部件，决定整机功耗、能效、可靠性和散热压力。目前，GPU 单卡功耗从 H100 的约 700W 提升到 GB200/300 的 1200W-1400W，整机柜功率已跃升至 100kW 以上，并不断向更高功率提升，要求供电系统具备更高的转换效率、功率密度与稳定性。

下游服务器电源模组的快速迭代更新，要求服务器电源 PCB 持续向更高层板发展，围绕高散热、高可靠性方向不断进行技术创新；生产工艺方面，对多次压合尺寸稳定性控制、精细线路技术、Laser 微孔技术、盲孔电镀填孔技术、高速材料混压技术、高精度阻抗控制、互联可靠性等技术能力提出了更高的要求。

针对高速增长的高端产品需求，公司需着力布局先进技术和装备，以满足核心战略客户的要求。

（3）降低国际贸易摩擦风险，提升公司整体抗风险能力

随着公司境外销售的不断增加，公司对境外市场的重视程度日益提高。但近年来，国际贸易摩擦持续升级，各种贸易壁垒令国内企业产品出口压力增加，以技术标准、知识产权、关税为代表的贸易壁垒层出不穷，给产业链带来的潜在风险不容忽视；同时，海外客户对供应链地缘风险分散的战略重视度显著提高，普遍通过优化供应链节点、分散产能布局等方式，对冲物流时效波动与单一产能中断风险，以强化供应链稳定性与安全性。

在此背景下，公司在泰国投资扩建生产基地，既能精准匹配海外客户供应链布局需求、进一步巩固客户合作粘性，又能增强应对宏观经济波动、产业政策调整及国际贸易格局变化的战略灵活性，通过生产基地的全球化分散布局优化供应链韧性，进而显著提升公司整体抗风险能力。

3、项目实施的可行性

（1）良好的经营环境为项目开展提供良好的外部环境

近年来，在“一带一路”倡议下，中泰两国经贸加速发展，在科技、教育、文化、卫生等领域交流合作日益密切，全面战略合作伙伴关系不断发展。中泰两国是 RCEP 共同成员国，中国已连续多年来稳居泰国最大贸易伙伴地位。而泰国是中国在东南亚的重要贸易伙伴，泰国的“东部经济走廊”项目与中国共建“一带一路”倡议深度对接，2025 年，中泰双边贸易额已达 1,532.6 亿美元，同比增长 14.4%。

中泰双方通过签署各类合作协定，为中国企业在泰国投资创造了有利环境。其中包括各方共同签署的 RCEP，以降低关税，简化原产地规则，促进区域内供应链整合与产品出口。这些协议有利于贸易便利化、基础设施建设、技术合作及产能协同，结合泰国本土的税收优惠和产业链配套，显著降低了中国企业在泰国建厂的成本与风险。

（2）当地完善的配套政策，有助于项目建设及生产运营

目前，东南亚投资布局成为 PCB 行业的新发展趋势，全球排名前列的 PCB 厂商基本均在东南亚投资布局，以泰国等为代表的东盟国家的 PCB 产业集群逐渐形成，目前已成为全球重要的 PCB 生产和消费区域之一。近年来，泰国承接了较多的电子信息行业企业的产能转移，产业集群快速发展，吸引了台达电子、施耐德、麦格米特和冠捷科技等各类元器件制造商。

此外，泰国作为快速发展的新兴市场经济体，其印制电路板的相关产业链配套设施日趋完善，具备土地、环保、人力、税收等方面的比较成本优势，可以较好满足公司建设海外生产基地的需要。

因此，本次海外生产基地的建设与实施，将有助于公司与下游客户开展更紧密的合作，更好地为现有及潜在海外客户提供产品服务，并充分利用当地丰富的资源和完善的产业配套，优化生产成本与税收成本，提升海外业务的市场竞争力。

（3）丰富的生产管理经验及海外客户资源积累，为项目建设提供重要保障

公司 2023 年开始已在泰国布局海外生产基地，于 2025 年度逐步达产并实现盈利。泰国子公司的成功达产，为公司布局海外产能积累了丰富的生产管理经验。同时，公司已组建专业和经验丰富的海外项目拓展团队，并积累了丰富的海外营销渠道。2023 年至 2025 年，公司海外客户拓展成效明显，境外主营业务收入由 28,728.80 万元增长至 62,040.15 万元，复合增长率达到 46.95%。

目前，公司已积累了丰富的海外客户资源，并与台达电子、三星电子、施耐德等知名海外客户保持稳定合作关系。未来，公司将持续加大海外市场业务拓展，加强与海外合作伙伴的交流合作，并不断开拓新客户、新订单，为泰国生产基地稳定运营提供充分保障。

4、项目投资概算

本项目总投资金额为 71,749.91 万元，本次拟使用募集资金投入 60,000.00 万元，项目投资结构如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	配套工程设施费用	25,703.38	35.82%

2	设备购置及安装费用	43,818.45	61.07%
3	铺底流动资金	2,228.08	3.11%
合计		**71,749.91**	**100.00%**

5、项目经济效益

经测算，本项目税后静态投资回收期为 7.40 年（含建设期），税后内部收益率为 12.44%。

6、效益预测的假设条件及主要计算过程

本项目实施完毕后，主要经济效益指标如下：

序号	经济技术指标	数据	备注
1	年销售收入（万元）	104,190.00	达产年度
2	年利润总额（万元）	7,622.78	达产年度
3	内部收益率（%）	12.44	税后
4	投资回收期（年）	7.40	税后，含建设期

（1）效益预测的假设条件

①国家现行法律、法规无重大变化，行业的政策及监管法规无重大变化；

②募投项目主要经营所在地及业务涉及地区的社会、经济环境无重大变化；

③行业未来形势及市场情况无重大变化；

④人力成本价格不存在重大变化；

⑤行业涉及的税收优惠政策将无重大变化；

⑥募投项目未来能够按预期及时达产；

⑦募投项目销售量按照生产量测算；

⑧无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（2）营业收入测算

本项目营业收入的测算以 2025 年公司分层产品市场价格为基础并结合目标客户产品现有价格情况保守估计未来市场价格，同时根据项目的投资进度和运行情况估算投产后产品销量，预估价格乘以销量为本项目营业收入。

（3）成本测算

本项目生产成本主要为直接材料费、直接人工成本和制造费用，直接材料费用参照同类产品成本数据估算确定，直接人工成本由定员人数及预计平均工资确定。制造费用由折旧费用、加工费、维修费、动力费等构成。

（4）期间费用测算

本项目期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用。根据公司 2025 年度销售费用、管理费用、研发费用占营业收入的比例来进行测算。

（5）税金测算

项目税金及附加的测算主要包含增值税、所得税等，相关税负按照税收法律法规的有关规定测算。

7、项目涉及土地、备案、环评审批情况

本项目建设地点位于泰国大城府育泰县堪韩镇 5 村 1 号，项目用地已由威泰电子有限公司取得，并取得地契编号为 43771 的土地所有权证书。

截至本募集说明书签署日，公司已取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400202600778 号）和广东省发展和改革委员会颁发的《境外项目投资备案通知书》（粤发改开放函[2025]319 号）；本项目所在的泰国洛加纳工业园已取得泰国自然资源和环境政策与规划办公室出具的环评批复，无需另行办理环评手续。

8、项目实施安排

本项目采用边建设边投产的方式，项目建设期 2 年，建成后的第 2 年达产 100.00%，本项目建设进度具体情况如下：

阶段/时间（月）	T+1				T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
可行性研究	■							
初步规划、设计	■							
房屋建筑及装修	■	■	■	■	■			
设备采购及安装					■	■	■	
人员招聘及培训					■	■	■	
试运行及投产						■	■	■

在项目实施过程中，公司将根据行业发展及市场需求情况及时调整项目的具体实施进度和募集资金使用进度。

（三）补充流动资金及偿还银行贷款

1、项目概况

公司拟将本次募集资金中的 10,000.00 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款，以满足公司业务发展对营运资金的需求，优化资本结构，保障公司主营业务持续稳健发展。

2、项目实施的必要性

近年来，公司经营规模持续增长，2023 年度至 2025 年度分别实现营业收入 82,269.05 万元、102,164.21 万元和 154,430.66 万元；与此同时，受益于下游市场需求的快速增长，公司承接产品订单规模保持良好的增长趋势，日常运营对流动资金的需求日益增加。基于下游市场需求，预计未来几年内公司仍将处于快速发展阶段，研发投入、生产经营等环节对流动资金的需求也将进一步扩大，仅依靠公司内部积累已经较难满足业务快速发展对资金的需求。

本次补充流动资金及偿还银行贷款将有助于增强公司资金实力，进一步优化公司的资本结构，提高偿债能力，增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

3、项目实施的可行性

本次向特定对象发行 A 股股票部分募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，符合现行法律法规及监管要求，方案切实可行。公司依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规范运作要求，构建了完善的公司治理体系，建立健全了各项规章制度和内部控制制度，并制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等作出了明确规定，确保公司募集资金的依法、合规使用。

4、本次补充流动资金规模的合理性测算

综合考虑公司的可自由支配资金、经营活动现金流量净额、最低现金保有量需求、营运资金需求、现金分红支出、有息负债情况、重大资本性支出等，以公司 2026 年 6 月 30 日的财务状况进行测算，公司模拟测算未来三年的资金

缺口为 249,040.62 万元，具体测算过程如下：

单位：万元

项目	备注	金额
截至 2026 年 6 月 30 日货币资金余额	①	43,852.60
其中：使用受限货币资金	②	15,879.73
交易性金融资产	③	-
前次募投项目未使用资金（不含受限货币资金部分）	④	24,839.38
截至 2026 年 6 月 30 日可自由支配现金	⑤=①-②+③-④	3,133.49
未来三年预计经营活动现金流入净额	⑥	30,841.73
最低现金保有量	⑦	23,921.40
未来三年新增营运资金需求	⑧	50,036.18
未来三年预计现金分红所需资金	⑨	10,952.87
未来三年资本性投资计划	⑩	141,815.27
归还有息负债	⑪	56,290.12
预计总体资金需求合计	⑫=⑦+⑧+⑨+⑩+⑪	283,015.84
总体资金缺口	⑬=⑫-⑤-⑥	249,040.62

（1）货币资金余额及受限资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 43,852.60 万元，其中受限货币资金余额为 15,879.73 万元，主要为银行承兑汇票保证金。

（2）未来三年预计经营活动产生的现金流量净额

公司过去三年经营活动现金流量净额占营业收入比重情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	154,430.66	102,164.21	82,269.05
经营活动产生的现金流量净额	-9,722.11	8,757.73	12,978.73
占比	-6.30%	8.57%	15.78%
三年累计经营活动产生的现金流量净额/三年累计营业收入	3.55%		

2023 年至 2025 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 12,978.73 万元、8,757.73 万元、-9,722.11 万元，占当年营业收入的比例分别为 15.78%、8.57%和-6.30%，存在一定波动，因此采用报告期平均比例 3.55%作为未来 3 年经营活动现金流量净额的预测参数。

2023 年至 2025 年，公司营业收入分别为 82,269.05 万元、102,164.21 万元和 154,430.66 万元，年均复合增长率为 37.01%。假定 2026 年至 2028 年公司的营业收入增长率保持每年 35%增速，且未来三年的经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例也保持在 2023 年至 2025 年的平均水平，则未来三年公司的经营活动现金流净额预测情况如下：

单位：万元

项目	2026E	2027E	2028E
营业收入	208,481.39	281,449.87	379,957.33
经营活动产生的现金流量净额	7,391.67	9,978.75	13,471.31
未来三年预计经营活动现金流入净额			30,841.73

注：2026 年-2028 年数据系公司为本次测算假定的数据，不构成盈利预测。

（3）最低现金保有量

考虑公司日常经营付现成本、费用和现金周转效率等因素，根据公司 2025 年度财务数据，经测算最低现金保有量金额为 23,921.40 万元，具体测算过程如下：

单位：万元

项目	公式	2025 年度
最低现金保有量	①=②/③	23,921.40
2025 年度付现成本总额	②=④+⑤-⑥	132,543.51
2025 年度营业成本	④	124,903.50
2025 年度期间费用	⑤	16,833.72
2025 年度非付现成本总额	⑥	9,193.71
货币资金周转次数（现金周转率）	③=360÷⑦	5.54
现金周转期	⑦=⑧+⑨-⑩	64.97
存货周转期	⑧	105.71
应收款项周转期	⑨	109.72
应付款项周转期	⑩	150.45

注：非付现成本总额=固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销

（4）未来三年新增营运资金需求

假设预测期间内公司主营业务、经营模式及各项指标保持稳定，不发生较

大变化，流动资产和流动负债与营业收入保持稳定的比例关系。用营业收入百分比法测算未来营业收入增长所引起的相关流动资产和流动负债的变化，进而测算 2026 年至 2028 年公司流动资金缺口，经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入比例采用 2025 年末的数据，测算过程如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2026 年 E	2027 年 E	2028 年 E
	金额	销售占比			
营业收入	154,430.66	100.00%	208,481.39	281,449.87	379,957.33
应收票据	8,822.28	5.71%	11,910.08	16,078.61	21,706.12
应收账款	45,189.86	29.26%	61,006.31	82,358.51	111,183.99
应收款项融资	245.02	0.16%	330.78	446.56	602.85
预付款项	749.44	0.49%	1,011.74	1,365.85	1,843.90
存货	40,393.42	26.16%	54,531.12	73,617.02	99,382.97
经营性流动资产①	**95,400.03**	61.78%	**128,790.04**	**173,866.55**	**234,719.84**
应付票据	24,381.76	15.79%	32,915.37	44,435.75	59,988.26
应付货款	34,685.17	22.46%	46,824.97	63,213.71	85,338.51
合同负债	113.07	0.07%	152.65	206.08	278.20
应付职工薪酬	1,777.17	1.15%	2,399.18	3,238.90	4,372.51
应交税费	180.30	0.12%	243.41	328.60	443.61
经营性流动负债②	**61,137.47**	39.59%	**82,535.59**	**111,423.04**	**150,421.11**
流动资金占用额③=①-②	**34,262.56**	22.19%	**46,254.45**	**62,443.51**	**84,298.74**
2026 年-2028 年流动资金缺口					**50,036.18**

（5）未来三年预计现金分红所需资金

2023-2025 年，公司现金分红比例情况如下：

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2025 年
营业收入	82,269.05	102,164.21	154,430.66
归母净利润	9,016.44	5,586.05	6,730.89
归母净利润/营业收入	10.96%	5.47%	4.36%
最近三年归母净利润占营业收入比重	6.30%		
现金分红金额	1,803.93	1,803.93	673.44

现金分红比例	20.01%	32.29%	10.01%
最近三年平均现金分红比例	20.07%		

根据公司董事会制定的《江西威尔高电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

假设未来 3 年的分红比例均为 20%，预测期营业收入规模基于前述假设增长率为 35%；参考 2023-2025 年的利润率水平，假设预测期归属于上市公司普通股股东的净利润为当年营业收入的 6.30%，则公司未来 3 年现金分红预计合计为 10,952.87 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 E	2027 年 E	2028 年 E
营业收入	208,481.39	281,449.87	379,957.33
归母净利润	13,125.07	17,718.85	23,920.44
现金分红金额	2,625.01	3,543.77	4,784.09
预计 2026 年-2028 年现金分红总计	10,952.87		

（6）未来三年资本性投资计划

除补充流动资金外，公司本次发行的募集资金将用于江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目、泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目，扣除非资本性支出后，项目总投资金额为 141,815.27 万元。

不考虑发行人未来三年可能的并购其他项目的重大资本支出安排，公司上述未来重大资本支出的资金需求为 141,815.27 万元。

（7）资产负债率、带息债务规模及还款安排

报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）分别为 26.68%、39.15%、47.23%和 53.15%，呈持续上升趋势。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司有息负债包括短期借款、一年内到期的长期借款，具体列示如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日
短期借款	50,396.00
一年内到期的长期借款	5,894.12
合计	**56,290.12**

综上，结合公司现有可自由支配资金、未来预计经营活动现金流量净额，以及未来公司日常运营、现金分红、偿还债务等资金需求，测算公司未来的总体资金缺口为 249,040.62 万元，高于本次募集资金总额 130,000.00 万元，本次融资具有必要性。

在剔除本次募投项目的情况下（即未来重大资本性支出需求中本次募投项目支出 141,815.27 万元），公司仍面临 107,225.35 万元的资金缺口，高于本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款的金额 10,000.00 万元，补充流动资金规模具有合理性。

本次募集资金拟用于补充流动资金及偿还银行贷款金额为 10,000.00 万元，未超过本次募集资金总额的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。发行人将根据未来业务的运行情况制定资金使用计划，合理有效地使用募集资金。

三、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

（一）实施能力

针对本次募投项目，公司在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备，公司具备募投项目的综合执行能力。相关情况如下：

1、人员储备

在人员储备方面，印制电路板行业是一个综合性较强的行业，具备多学科、跨领域的特点。公司深知在此行业背景下，人才团队的建设、管理与培养的重要性，高素质的研发人才和管理人才是公司持续发展的基石。公司已建立健全了公正、公平、公开的绩效考核制度，在报告期内重点提升人力资源综合管理

能力，不断加大对行业内高端人才的引进力度，对中层以上员工实施股权激励。多年来，公司已聚集了一批创新能力强、专业知识夯实、实战经验丰富的专业研发团队。其中，公司的核心技术人员均为 PCB 领域的资深专家，拥有丰富的一线技术研发及应用经验。

对于后续募投项目的落地，公司也将根据具体的实施计划，对相关领域的人才提前进行合理调配，尽可能向募投项目倾斜更多的专业人才资源，且公司也将根据募投项目实施的具体内容，加强相关人员的培训工作，提高执行团队的胜任力，助力相关募投项目的顺利落地。

2、技术储备

在技术储备方面，公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、江西省两化深度融合示范企业、江西省专精特新中小企业、江西省高成长性科技型企业、江西省专业化小巨人企业、江西省绿色工厂及智能制造标杆企业，拥有江西省省级企业技术中心、江西省“5G+工业互联网”应用示范工厂等荣誉称号。

多年来，公司一直以来都对产品的研发和技术的创新工作给予高度重视。公司长期顺应行业发展趋势、紧抓行业升级换代对产品的技术需求变化、关注行业前沿技术信息，并据此制定对应的研发计划并开展相关的产品、技术创新工作。公司目前已建立健全了完善的技术创新机制，在不断参与客户产品的技术研发、收集和分析下游产品变化相关信息的过程中，加强对电路板高精密、高集成、高速高频化、轻薄化、高散热等方向的研究；重点围绕厚铜技术、Mini LED、新一代通讯、AI 人工智能、汽车、新能源等领域和行业新趋势进行产品和技术开发；同时强化对电镀、钻孔、压合、表面处理等主要制程生产工艺的优化和改进，通过工艺创新的方式提高公司的生产效率和产品良率，不断拓展技术储备的深度及宽度，以满足日新月异的客户产品需求。如在 AI 电源产品领域，特别是 DC-DC 产品上突破 30 层产品技术壁垒，公司通过对高散热材料的研究测试，特殊埋铜工艺的导入，助力 DC-DC 高端电源模块实现批量生产；公司在高阶 HDI 产品上也已取得了技术突破，在小尺寸 Mini LED 产品上实现细密灯珠线路的批量生产。

在加大研发人才及技术储备的基础上，公司内部还积极推进关键技术最终形成行业标准，提升各研发项目的专利转化率及论文发表率，据此提高公司的行业知名度，塑造公司的技术形象。

未来公司还将进一步加大研发的相关投入，提高相关新技术的应用及产出能力、相关研发人才的管理能力，为本次募投项目的顺利落地提供强有力的技术保障。

3、市场储备

在市场储备方面，公司自成立以来，一直以服务客户为本。由于 PCB 产品定制化程度较高，故行业内国际知名客户通常对产品的各方面要求都更为严苛，具体体现为对供应商资质的要求高、审核周期长、认证时间久等。一旦双方达成了合作关系，相关客户基于对技术要求、产品质量、采购成本等多方面综合考虑，一般会选择与供应商形成长期稳定的合作关系。

不同下游应用领域对 PCB 的技术要求各有不同，若在特定领域获得知名品牌客户的认可，则足以证明公司在该领域的产品值得信赖、技术水平较为先进，可以在激烈的市场竞争中形成其独有的品牌优势。目前，公司已与如台达电子、施耐德、三星电子、冠捷科技、比亚迪、长城电源、欧陆通股份、富士康、麦格米特、新雷能等诸多国际知名客户达成了长期战略合作关系，并多次获得上述客户颁发的奖项，在业内形成了良好的口碑效应。优质的品牌客户资源不仅能够提升公司的品牌形象、获得长期稳定的订单资源，还能为公司未来获得更多新的业务合作机会及市场空间提供助力。近几年，在相关产业的驱动下，相关产品迭代升级加速，威尔高依托多基地的技术研发与快速量产优势，与客户深度绑定，共同开发新产品、研究新材料。公司经年累月构建的丰富且优质的客户资源及稳定的合作关系将为本次募投项目的建设及投产提供良好的市场基础。

综上所述，公司在人员、技术和市场等方面均有着较为丰富的储备，能够为本次发行募集资金投资项目的实施落地提供充足的保障。

（二）资金缺口的解决方式

本次募投项目总投资额为 156,580.79 万元，拟使用募集资金投资金额为

130,000.00 万元。本次募集资金到位后，公司根据制定的募集资金投资计划具体实施。在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。

四、本次募投项目相关既有业务的发展概况、扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性

（一）本次募投项目与公司既有业务的关系

公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，主要产品包括双面板、多层板，下游主要应用于 AI 服务器电源、工业控制、汽车电子、显示、数字通讯等领域。本次募集资金投资项目均围绕企业的主营业务展开，符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，系公司在产业发展及业务升级过程中的现实需求。

本次募投项目通过引进自动化、智能化生产线，多维度提升公司的制程能力，突破技术瓶颈、提高生产效率、提升产品良率、缩短交货周期、节约人工成本与能源消耗，有利于公司进一步提升产品结构，促进产品、制造升级，巩固公司的竞争优势及行业地位，增强企业的综合竞争力及持续盈利能力。

本次募投项目与公司当前主营业务方向相符合，有利于公司巩固行业地位，进一步提升公司的技术水平和服务能力，从而进一步增强公司的盈利能力和核心竞争力，符合公司战略发展目标。

（二）本次募投项目与公司前次募投项目的关系

本次募投项目江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目和泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目与前次募投项目年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路板项目和超募资金用于投资建设泰国威尔高年产 60 万㎡线路板项目的联系与区别如下：

项目	区别		联系
	前次募投项目	本次募投项目	

	年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路板项目	**超募资金用于投资建设泰国威尔高年产 60 万㎡线路板项目**	**江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目**	**泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目**	
所属行业	-	-	-	-	均属于印制电路板的研发、生产和销售，即“电子元件及电子专用材料制造”下的“电子电路制造
实施主体	发行人	泰国威尔高	发行人	泰国威尔高	-
实施地点	江西省吉安市	泰国大城府	江西省吉安市	泰国大城府	-
具体产品	工业电源、电控、电机、Mini LED	AI 电源（AC-DC)	聚焦 **AI 电源（一次电源、二次电源、三次电源）**、显示类及工业控制领域	聚焦 **AI 电源（一次电源、二次电源、三次电源）领域**	扩大 AI 电源相关产品生产规模，丰富产品结构
生产工艺	板边镀铜、POFV 工艺、电感测试、反射率 ≥85%，黄变值 B≤2、多种材料混压、PTH 半孔、背钻工艺	雷射/机械钻孔、压合、图形转移、酸碱性蚀刻、脉冲电镀、CCD	镭射/机械钻孔、压合、图形转移、酸碱性蚀刻、脉冲电镀、mSAP、Solder mask、表面处理、CCD、AVI、ET	镭射/机械钻孔、压合、图形转移、酸碱性蚀刻、脉冲电镀、mSAP、Solder mask、表面处理、CCD、AVI、ET	进一步提升高多层板的生产工艺，提升产品的线路精细度、对位精度、多次压合尺寸稳定性、高精度阻抗、互联可靠性等性能
应用领域	工业控制（三电）、显示、通讯	AI 服务器电源	AI 电源、**显示**、工控产品等	AI 电源等	在现有应用领域的基础上，进一步增加 AI 电源等领域占比

注：本次募投项目具体产品将根据公司现有产品结构进行布局，AI 电源产品主要以一次电源板为主。

公司本次募投项目与前次募投项目的联系在于两者均系围绕公司主营业务、扩大公司产品产能开展，以增强公司的市场竞争力和持续盈利能力。在生产设备、生产工艺和客户群体形成衔接和提升。公司本次募投项目旨在巩固原有产品和应用领域的同时，加大对 AI 电源 PCB 领域的市场开拓力度。

综上，本次募投项目与前次募投项目均投向公司主业，在产品类型、应用领域、产品层数、生产设备、生产工艺等方面有所区别，不存在重复建设的情形。

（三）扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性

详见本募集说明书“第四节•二•（一）•2、项目实施的必要性”和“第四节•二•（二）•2、项目实施的必要性”。

五、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金，将全部投向公司既有主营业务。项目实施后，公司业务范围将保持稳定，不涉及业务或资产层面的重大整合；同时，项目将有效拓宽产品矩阵、优化产业生态，显著增强公司核心竞争力。

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，资本实力和抗风险能力将得到提升，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司净资产与总资产规模将实现显著提升，资本实力与抗风险能力同步增强。这不仅进一步夯实了公司的财务根基，更为后续战略布局和业务拓展奠定了坚实基础，确保在市场竞争中具备更强的资源储备与可持续发展能力。

六、募投项目实施后新增同业竞争或关联交易的情况

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争不会因本次发行而发生重大变化。本次向特定对象发行也不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增同业竞争或关联交易。

七、募集资金投资项目涉及报批事项情况

截至本募集说明书出具日，江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目已完成环评和项目备案手续；泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目已取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400202600778 号）和广东省发展和改革委员会颁发的《境外项目投资备案通知书》（粤发改开放函[2025]319 号）；截至募集说明书签署日，泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目所在的泰国洛加纳工业园已取得泰国自然资源和环境政策与规划办公室出具的环评批复，无需另行办理环评手续。

募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理政策以及其他法律、法规和规章的规定。

八、募集资金投资项目可行性分析结论

公司本次向特定对象发行 A 股股票具备必要性与可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，本次发行将有利于进一步完善公司产业布局，提高公司经营业绩，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

（一）本次发行对公司业务及资产的影响

本次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金，将全部投向公司既有主营业务。项目实施后，公司业务范围将保持稳定，不涉及业务或资产层面的重大整合；同时，项目将有效拓宽产品矩阵、优化产业生态，显著增强公司核心竞争力。

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，资本实力和抗风险能力将得到提升，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中的与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

（三）本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司总股本将相应增加，原股东持股比例发生被动稀释。但本次发行前后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，因此，本次发行不构成公司控制权变更。

本次发行完成后，不会导致公司股权分布不具备在深交所的上市条件。

（四）本次发行对高级管理人员结构的影响

本次发行完成后，公司预计不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务结构的影响

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，项目实施后所产生收

益仍为公司主营业务收入。因此，公司整体业务架构与收入构成不会因本次发生产生实质性变动，主营业务方向及战略重心将持续保持稳定。

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次股票发行完成后，公司净资产与总资产规模将实现显著提升，资产负债结构将得到进一步优化，资本实力与抗风险能力同步增强。这不仅进一步夯实了公司的财务根基，更为后续战略布局和业务拓展奠定了坚实基础，确保在市场竞争中具备更强的资源储备与可持续发展能力。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本将相应增加，资本实力显著增强，为后续战略布局奠定坚实基础。募集资金将全部投向主营业务领域，聚焦公司长期发展所需的战略资源投入。鉴于募投项目需经历必要的建设周期及产能爬坡阶段，其效益的全面释放需要一定时间。因此，短期内公司净资产收益率及每股收益指标或将面临阶段性摊薄压力，但长期战略价值与持续发展动能将得到实质性提升。

从长远来看，本次募集资金投资项目的实施将对公司主营业务的发展产生积极影响，有利于提升公司的综合竞争力，随着募集资金投资项目预期效益的实现，公司的盈利能力将会进一步增强。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司筹资活动现金流入将大幅增加，同时随着募投项目的建设，公司投资活动现金流出也将相应增加。待公司募投项目投入运营并产生效益后，公司的竞争实力不断提升，将有助于扩大公司经营活动现金流入规模。

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争不会因本次发行而发生重大变化。本次向特定对象发行也不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增同业竞争或关联交易。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形

截至本募集说明书出具日，本公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。

本次发行不会导致公司资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，也不会产生公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将增加，资产负债率会随之下降，财务结构将进一步优化，抗风险能力将进一步增强，实现长期可持续发展。

第六节 最近五年内募集资金运用的基本情况

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

按前次募集资金到账时间计算，最近五年内，公司进行过一次募集资金行为，具体如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）同意注册，威尔高 2023 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,655,440 股，发行价格为 28.88 元/股，募集资金总额为人民币 971,969,107.20 元，扣除发行费用（不含税）100,383,184.67 元后，实际募集资金净额为 871,585,922.53 元。

募集资金到账时间为 2023 年 9 月 1 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 1 日出具天职业字[2023]45416 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、前次募集资金基本情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用前次募集资金为人民币 64,529.98 万元，其中投入“年产 120 万平方米印制电路板项目”和“泰国威尔高年产 60 万㎡线路板海外建厂项目”募集资金项目 48,497.98 万元，使用超募资金永久补充流动资金 16,032.00 万元，累计使用募集资金占实际募集资金净额的比例为 74.04%。募集资金未使用完毕的原因是项目尚在建设中，尚未完成投资，剩余资金将继续用于募集资金项目建设。公司前次募集资金使用和结存情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金净额	**87,158.59**
加：以自有资金支付且未置换的发行费用	28.58
减：募集资金累计投入	64,529.98
其中：年产 120 万平方米印制电路板项目	37,497.98
超募资金累计使用总额	27,032.00

项目	金额
其中：超募资金永久补流	16,032.00
泰国威尔高年产 60 万㎡线路板海外建厂项目	11,000.00
减：银行各项费用（手续费、服务费等）	1.07
加：募集资金利息收入	2,183.25
二、2026 年 6 月 30 日募集资金余额	**24,839.38**
其中：募集资金专项账户存款余额	839.38
现金管理转出余额	14,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	10,000.00

注：公司以自有资金支付印花税、登记费、公证费等发行费用共计 285,820.73 元，未使用募集资金进行置换，因此在计算募集资金结余时，将其从募集资金净额中加回。

公司前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额：		87,158.59	已累计使用募集资金总额：	64,529.98
			各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额：		-	2023 年：	8,109.60
变更用途的募集资金总额比例：		-	2024 年：	10,925.23
			2025 年：	20,438.40
			2026 年 1-6 月：	25,056.75

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
一、承诺投资项目										
1	年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路板项目	年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路板项目	60,126.59	60,126.59	37,497.98	60,126.59	60,126.59	37,497.98	22,628.61	2027 年 9 月
承诺投资项目小计			**60,126.59**	**60,126.59**	**37,497.98**	**60,126.59**	**60,126.59**	**37,497.98**	**22,628.61**	

二、超募资金投向										
1	超募资金永久补充流动资金	超募资金永久补充流动资金	16,032.00	16,032.00	16,032.00	16,032.00	16,032.00	16,032.00	-	不适用
2	超募资金用于投资建设泰国威尔高年产 60 万㎡线路板项目	超募资金用于投资建设泰国威尔高年产 60 万㎡线路板项目	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	2024 年 6 月 24 日
超募资金投向小计			**27,032.00**	**27,032.00**	**27,032.00**	**27,032.00**	**27,032.00**	**27,032.00**	**-**	
合计			**87,158.59**	**87,158.59**	**87,158.59**	**87,158.59**	**87,158.59**	**64,529.98**	**22,628.61**	

截至 2026 年 9 月 14 日，公司前次募投项目已累计使用募集资金 72,101.17 万元，扣减补充流动资金后已累计使用募集资金 56,069.17 万元，未扣减补充流动资金后的前次募集资金使用比例为 82.72%，扣减补充流动资金后的前次募集资金使用比例为 78.83%，扣减超募资金后的前次募集资金使用比例为 74.96%。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

发行人前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期的实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路板项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注1]
2	超募资金用于投资建设泰国威尔高年产 60 万㎡线路板项	88.87%	不适用	不适用	-3,924.61	2,310.01	1,165.19	-449.41	不适用[注2]

	目								
3	超募资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注3]

注 1：2024 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将募投项目“年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路板项目”达到预定可使用状态的日期完成时间延长至 2027 年 9 月，目前该项目仍在建设中，暂未全部达到预定可使用状态；

注 2：公司超募资金投资泰国建设“年产 60 万㎡线路板项目”于 2024 年 6 月 24 日投产，预计 2026 年达产，由于预期效益指标需依据项目完全建成并达产后的全年标准测算，因此不适用“是否达到预计效益”；

注 3：公司募集项目“超募资金永久补充流动资金”无法单独核算效益。

前次募投项目为更好地适应市场需求，实现分步骤有序达成产能升级、扩容目标，并降低募集资金投资风险和经营风险、保障资金的安全和合理运用，提升资金使用效率，公司审慎控制了项目投资建设进度，将募投项目“年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路板项目”达到预定可使用状态的日期完成时间延长至 2027 年 9 月。

2024 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将募投项目“年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路板项目”达到预定可使用状态的日期完成时间延长至 2027 年 9 月，目前该项目仍在建设中，暂未达到预定可使用状态。

“超募资金永久补充流动资金”项目不直接产生效益，因此无法单独核算效益。募集资金用于该项目有利于提高公司的抗风险能力，增强核心竞争力，保持公司经营稳定性，促进公司可持续发展。

四、尚未使用的前次募集资金的后续使用计划

公司尚未使用的前次募集资金严格按照募集资金专款专用的原则使用，后续将按照投入计划持续投入相应的前次募集资金项目。

五、前次募集资金投资项目变更情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

六、闲置募集资金的使用情况

2023 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 59,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 55,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，拟

用于购买安全性高、流动性好的产品，以增加募集资金收益。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 55,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 14,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

存放银行	产品名称	产品类型	金额	存入日期	到期日期	利率
中国工商银行股份有限公司吉安支行	单位大额存单	保本固定收益	3,000.00	2025/10/20	2026/10/20	1.20%
中国建设银行股份有限公司吉安高新支行	单位大额存单	保本固定收益	11,000.00	2025/10/17	2026/10/17	1.20%

七、会计师事务所出具的专项报告结论

立信会计师事务所对《江西威尔高电子股份有限公司截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《江西威尔高电子股份有限公司截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZI10736 号），发表意见为：“威尔高截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定编制，如实反映了威尔高公司截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况。”

八、超过五年的前次募集资金用途变更情况

截至本募集说明书签署日，公司的前次募集资金情况仅为 2023 年首次公开发行股票，不存在超过五年的前次募集资金用途变更的情况。

第七节 与本次发行相关的风险因素

投资者在评价发行人本次向特定对象发行 A 股股票时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述风险因素。

一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

（一）宏观经济波动风险

公司主营业务为各类印制电路板的研发、生产与销售业务，印制电路板作为电子元器件基础行业，其应用范围广泛，与全球宏观经济形势关联度较高。宏观经济波动将对 PCB 下游行业如 AI 服务器电源、工业控制、汽车电子、显示、消费电子、数字通讯等行业产生不同程度的影响，进而影响 PCB 行业的整体需求。如果未来全球地缘政治风险上升，贸易保护主义抬头以及下游行业出现周期性波动，或国家财政、货币、贸易等宏观政策发生不利调整，可能对公司经营业绩产生一定影响。

（二）行业产能大幅扩张导致产品价格下降的风险

近年来，全球 PCB 产业重心持续向国内聚集，我国已发展成为全球印制电路板的主要生产基地。近几年国内 PCB 产能仍处于扩张态势，若未来行业出现市场竞争加剧导致产品价格下行，而公司未能持续提升技术水平、生产管理、产品质量以有效应对竞争，则存在盈利能力下滑的风险。

（三）原材料供应紧张及价格波动风险

公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、金盐等，主要原材料价格受国际市场铜、金等大宗商品的影响较大。主要原材料供应链的稳定性和价格波动将影响公司的生产稳定性和盈利能力；若未来原材料供应紧张、价格大幅上涨，而公司不能通过提高产品价格或通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，可能出现原材料供应不足或盈利能力下降等情形，将对公司的经营成果产生不利影响。

（四）市场竞争风险

PCB 行业下游应用领域广泛，参与者众多且集中度低，市场竞争较为激烈。行业龙头企业通过技术创新、规模扩张及供应链整合不断增强市场影响力，而中小企业则面临更大生存压力。若公司未能及时把握市场机遇，持续提高技术水平、生产管理能力和产品质量以应对市场竞争，快速适应产品开发和市场策略的变化，可能会在市场竞争中失去优势，存在因市场竞争加剧导致经营业绩下滑的风险。

（五）财务风险

1、毛利率波动的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 22.97%、18.09%、19.12%和 18.65%，受行业竞争激烈、原材料价格上涨等因素影响，公司综合毛利率整体有所波动。

如果未来行业竞争进一步加剧导致产品销售价格下降，而公司未能及时通过提高技术水平和产品质量以应对市场竞争；或者原材料价格上升，而公司未能有效控制产品成本等情况发生，则存在毛利率下滑和盈利能力下降的风险。

2、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 16,176.04 万元、25,893.26 万元、40,393.42 万元和 64,692.93 万元。报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 1,127.85 万元、3,056.64 万元、4,006.30 万元和 3,209.02 万元，占当期存货余额的比重分别为 6.52%、10.56%、9.02%和 4.73%。如果出现因市场环境发生重大不利变化或者公司存货管理不到位导致存货出现积压、减值等情况，可能给公司经营业绩和财务状况带来不利影响。

3、应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 26,748.85 万元、30,068.16 万元、47,608.91 万元和 60,996.74 万元，各期末应收账款余额呈现增长趋势，占营业收入的比例分别为 32.51%、29.43%、30.83%和 31.14%（已年化处理）。公司的应收账款主要为账龄在一年以内的应收账款，账龄较短。如果部分客户出现支付困难、拖延付款等现象，公司将面临无法及时收回货款的风险，从而对公

司的资金周转和生产经营产生不利影响。

（六）税收优惠政策变动风险

公司于 2023 年 11 月，取得了江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202336000129），认定有效期三年。惠州威尔高电子有限公司分别于 2022 年 12 月和 2025 年 12 月取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202244000958）和《高新技术企业证书》（证书编号：GR202544002042），认定有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，公司及子公司惠州威尔高所得税适用 15%的优惠税率。

如果有关高新技术企业税收优惠政策发生变化，或公司及子公司惠州威尔高不再符合高新技术企业税收优惠条件，使得公司及子公司惠州威尔高不能继续享受 15%的优惠所得税税率，公司及子公司惠州威尔高的所得税费用将大幅上升，盈利水平将受到不利影响。

（七）技术持续研发迭代风险

PCB 的研发、生产涉及电子、机械、材料、计算机等多个学科领域，需要长期不断进行学习、总结与积累，持续关注行业及学科的最新动态，方能够保证产品生产的稳定性和连续性。同时，公司 PCB 产品下游应用领域包括 AI 服务器电源、工业控制、汽车电子、显示、消费电子、数字通讯等行业。近年来，下游行业科技、技术迅速发展，提高了客户对相关 PCB 产品在技术难度、产品质量、精密程度等方面的要求。因此，PCB 生产企业需要具备较强的技术水平和研发能力，时刻紧跟行业发展最新趋势，才能够研发、生产出客户所需要的产品。未来如公司未能够对技术、工艺进行持续优化迭代，则可能面临丧失技术优势的风险，进而对公司市场竞争力、行业地位及经营业绩产生不利影响。

（八）核心技术人员流失风险

PCB 行业生产工艺复杂，技术难度大，存在技术壁垒，需要确保一定规模、具有相应知识水平的研发技术人员团队，方能够保持产品研发能力，不断提升生产工艺和产品稳定性、可靠性水平。随着市场环境、经济政策等方面的变化，

如公司未能够提供具有市场竞争力的薪酬待遇和切实可行的激励机制，公司将面临核心研发技术人员流失或无法及时引进研发技术人才的风险，进而对公司业务造成不利影响。

（九）汇率波动风险

汇率波动对公司的影响主要体现在：一方面，受人民币汇率波动影响，以本币计量的营业收入变化，对主要产品的毛利水平产生直接影响；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，亦直接影响公司业绩。

报告期，公司境外主营业务收入占主营业务收入的比例分别为 38.52%、36.78%、46.20%和 43.00%。若未来人民币出现大幅升值，一方面会导致公司汇兑损失增加，另一方面相对国外竞争对手的价格优势可能被减弱，假设在外币销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入减少，可能对公司经营业绩造成不利影响。

（十）人工成本上升的风险

随着产能持续扩张，公司对劳动力需求持续增加。若未来区域及行业人工成本持续攀升，而公司未能通过自动化生产技术优化人力需求或提升生产效率，可能对成本结构和盈利能力产生不利影响，进而对公司经营业绩及市场竞争力产生一定的不利影响。

（十一）贸易摩擦风险

报告期内公司主营业务收入中外销占比分别为 38.52%、36.78%、46.20%及 43.00%，产品主要出口地包括东南亚等地区。尽管目前我国已经成为全球最大的 PCB 生产基地，且具备较强的产能消化能力，但如果因贸易摩擦而导致对我国 PCB 产品采取限制政策、提高关税及其他方面的贸易保护主义措施，将会对我国 PCB 行业造成一定冲击，从而可能对公司的业务发展产生不利影响。

二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素

（一）本次发行的审批风险

本次向特定对象发行 A 股股票尚需深交所审核通过并取得中国证监会同意

注册的批复，能否取得有关主管部门的批准，以及最终取得上述批准的时间存在不确定性。

（二）发行风险

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，且最终根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定，发行价格不低于定价基准日（即发行期首日）前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的百分之八十。本次发行的发行结果将受到发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响。因此，本次发行存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

（三）股价波动风险

股票市场投资兼具收益与风险。公司股票价格受公司基本面、宏观经济、政策调控、市场情绪等多重因素共同影响，上述因素可能导致股价波动，从而给投资者带来一定风险。

此外，本次向特定对象发行股票尚需取得相关监管部门的审批通过，审批流程存在一定周期。在此期间，若股票市场环境出现重大变化，或投资者预期发生调整，可能引发公司股票价格波动，进一步放大投资者面临的不确定性风险。

三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素

（一）募集资金投资项目实施风险

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目是公司基于当前市场环境、行业发展趋势及自身业务发展规划，经研究与论证后确定。但募投项目的实施需要一定周期，在项目推进过程中，宏观经济政策调整、产业监管政策变动、行业竞争格局变化、市场需求波动等因素均可能发生不利变化，进而对募投项目的实施进度、投入成本及预期收益产生较大影响。**本次募投项目聚焦 AI 电源（一次电源、二次电源、三次电源）、显示类及工业控制领域，上述领域中，三次电源尚未实现批量销售，若未来不能顺利量产，将对募投项目的实施效果**

与预期效益产生不利影响。此外，在项目实施过程中，若出现募集资金未能按期足额到位、项目实施进度延迟等不确定性事项，亦将对募投项目的实施效果与预期效益带来不利影响。

（二）募投项目收益不及预期的风险

公司本次募集资金用于“江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目”、“泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目”以及“补充流动资金及偿还银行贷款”。未来整体市场环境、供求关系尚存在不确定性，若在募投项目实施过程中宏观经济、产业政策、市场需求等发生重大不利变化，可能出现行业竞争加剧的情形，或者产品技术路线发生重大更替、公司市场开拓不力、无法满足下游客户需求或其他不可抗力因素出现，**可能导致募投项目产品价格下行或销量不及预期**，进而可能导致募集资金投资项目实际效益不及预期**的风险**。

（三）新增产能消化风险

2025 年度，公司印制电路板产能规模为 245.71 万平方米/年，本次募集资金投向围绕公司 PCB 主业进行布局，旨在增加公司高端产品产能，项目建成达产后，将形成年产 264 万平方米高端 AI 类及高多层电路板产能；**此外，前次募投项目建成后将新增产能 120 万平方米/年，累计新增产能 384 万平方米/年，较 2025 年度产能扩产 1.56 倍**。当前较多同行业公司普遍在进行规模扩张，积极增加产能，现阶段行业呈现集中扩产态势，**产能集中释放的累积效应预计在 2-3 年集中显现，与发行人本次募投项目的投产时间窗口存在一定重叠，**未来可能因新增产能陆续释放引发需求不足的风险，可能对募投项目产能消化形成压力。**本次募投项目重点聚焦 AI 服务器电源等领域，**如果项目建成投产后，**AI 服务器电源市场增长不及预期，**PCB 行业出现下游需求增长放缓甚至下滑、行业内同质化竞争加剧、新增产能投产速度过快、重大技术革新并形成替代、下游市场需求发生重大变化、公司客户开拓力度不及预期或其他重大不利变化的情形，可能导致市场需求增长不及预期以及产品推广困难，进而可能导致公司募投项目新增产能无法及时消化，**本次募投项目新增产能面临一定的产能消化风险**。

（四）固定资产折旧增加对公司经营业绩产生不利影响的风险

公司本次募集资金拟主要投向“江西年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目”和“泰国年产 120 万平方米高多层印制电路板智能制造项目”，同时，公司前次募投项目“年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路板项目”正处于建设期，公司计划投入较大金额用于设备采购和工程建设等资本性支出。公司前次及本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产较本次发行前将有所增加，由此带来每年固定资产折旧、无形资产摊销的增长，预计达产年度新增折旧及摊销金额为 14,964.10 万元。**投产初期折旧计提与收入贡献之间存在明显的时间错配，导致投产初期项目利润为负**，募集资金投资项目的建设需要一定的周期，**折旧及摊销为固定成本，在产能利用率不足的情形下，单位产品折旧成本被动抬升，项目盈利空间将被压缩。**若本次募投项目建设过程中公司经营环境发生重大不利变化或者募投项目建成后经济效益不及预期，**募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响**。

（五）即期回报被摊薄的风险

本次发行的募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量有所提高，而募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，在总股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。若募集资金使用效益短期内难以全部实现，或公司利润增长幅度将小于净资产和股本数量的增长幅度，公司的每股收益和加权平均净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。

（六）管理风险

本次募集资金投资项目实施后，公司业务规模与经营布局将进一步拓展，整体经营体量与业务复杂度持续提升，对公司管理团队的综合管理能力提出了更高要求。公司将在战略规划统筹、管理制度建设、组织架构优化、生产运营管理、资金使用管控及内部控制体系建设等多个维度面临更为复杂的挑战。若公司管理能力未能同步提升，无法高效落地发展战略、匹配业务扩张节奏，导致运营管理能力与业务布局需求不相适配，将对公司整体运营效率与核心市场

竞争力产生不利影响。

第八节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

邓艳群　　贾晓燕　　陈　曦

刘木勇　　唐艳玲

高级管理人员签字：

邓艳群　　贾晓燕　　肖如意

江西威尔高电子股份有限公司

2026 年 11 月 11 日

发行人审计委员会声明

公司审计委员会承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

审计委员会委员签字：

刘木勇　　唐艳玲　　陈　曦

江西威尔高电子股份有限公司

2026 年 11 月 11 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：吉安嘉润投资有限公司

控股股东法定代表人：

邓艳群

实际控制人：

邓艳群 陈 星

江西威尔高电子股份有限公司

2026 年 11 月 11 日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：

杨改明　　曾文强

项目协办人：

吴健飞

法定代表人：

徐春

国联民生证券承销保荐有限公司

2026 年 11 月 11 日

保荐人总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人总经理签名：

张明举

国联民生证券承销保荐有限公司

2026 年 11 月 11 日

保荐人董事长声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人董事长签名：

徐春

国联民生证券承销保荐有限公司

2026 年 11 月 11 日

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《江西威尔高电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（签字）：

李 忠

经办律师（签字）：

宋幸幸 童匆聪

罗晓丹

广东信达律师事务所

2026 年 11 月 11 日

五、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读江西威尔高电子股份有限公司的募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对江西威尔高电子股份有限公司在募集说明书中引用的审计报告等文件内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

邢向宗

方思铭

会计师事务所负责人：

杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 11 月 11 日

六、发行人董事会声明

（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

除本次发行外，公司将根据业务发展规划、项目投资进度等情况，并结合公司资本结构、融资成本等因素综合考虑是否实施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律、法规履行相关审议程序和信息披露义务。

（二）关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施

1、加强主营业务建设，提高公司持续盈利能力

为加强主营业务建设，持续提升核心竞争力及持续创新力，有效防范并化解经营风险，公司将在现有业务优势的基础上进一步投资建设生产线，从产品结构、市场布局及技术实力等多方面持续提升公司核心竞争力，继而提升公司的持续盈利能力。

2、提高日常经营效率，降低运营成本，提升经营业绩

公司将持续推进内部流程优化及制度建设，不断丰富完善公司业务发展模式，巩固并提升公司的市场地位和市场竞争力，提高公司盈利能力。此外，公司将加强日常经营管理和内部控制，推进全面预算管理，加强投资管理，全面提升公司的日常经营效率，降低运营成本，提升经营业绩。

3、加快募投项目建设，争取早日实现项目预期效益

公司将积极加快募投项目的建设速度，尽快提升公司盈利能力，并在资金的计划、使用、核算及防范风险方面强化管理，以确保募投项目的顺利建设，在实现预期收益的前提下尽可能为股东提供最大的投资回报。

4、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将不断完善公司治理结构，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和审慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司长期稳定的发展提供坚实的制度保障。

5、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则并制定了相应的股东回报规划。本次发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，切实保护公众投资者的合法权益。

上述填补回报措施不等于对公司未来的利润情况做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担相关赔偿责任，敬请广大投资者注意相关的投资风险。

（三）相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

1、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东吉安嘉润投资有限公司，实际控制人邓艳群、陈星承诺如下：

“1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

3、对本公司/本人的职务消费行为进行约束；

4、不动用公司资产从事与本公司/本人履行职责无关的投资、消费活动；

5、积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况挂钩；

6、在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本公司/本人承诺与该等规定不符时，本公司/本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。”

2、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况挂钩；

5、在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。”

（本页无正文，为《江西威尔高电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书董事会声明》之盖章页）

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日